

COMPUTEX 2026 참관기

Ecosystem-Wide Innovation



클라보

반도체 고영민 ym.ko@daolfn.com

전기전자 김연미 ym.kim@daolfn.com



CONTENTS

03 I. Summary

05 II. 반도체: NVIDIA가 원하는 모든 방향이 공통적으로 가리키는 것은 메모리

- 1. Intro) AI 모델 기술 변화가 말해주는 것
- 2. NVIDIA가 원하는 것 - ① All in One
- 3. NVIDIA가 원하는 것 - ② $1 \pm 1 = 3$

21 III. 전기전자: AI 랙 고도화가 이끄는 전력·냉각 생태계의 확장

- 1. 칩 밖으로 번지는 AI 인프라 혁신
- 2. 전력: 800V HVDC 랙의 본격 등장
- 3. 냉각: D2C 액체냉각 표준화 & 액침냉각 확장 가능성

I. Summary

I. Summary

COMPUTEX 2026 참관기: Ecosystem-Wide Innovation

● 반도체: NVIDIA가 원하는 모든 방향이 공통적으로 가리키는 것은 메모리 | 관심종목: 삼성전자, SK하이닉스

- AI 모델의 기술 방향성을 요약하면 '연산의 다다익선'. 에이전트, Physical AI가 개화하는 과정에서 반복 루프 연산 구조 하 연산의 횟수가 성능을 결정하는 흐름
- 생태계 전반이 소수 빅테크의 AI 인프라를 공유하는 과정에서 실질적인 비용 부담 구조로 흘러갈 전망 → 중기 CapEx 우려는 점점 불필요
- 다만 단기적으로 빅테크가 직면한 인프라 측면 어려움은 GPU 확대에 대한 비용 및 기술 부담. 이를 다른 하드웨어 생태계를 통해 단기 극복하는 모습 포착
- AI 인프라 생태계의 최전방에 있는 NVIDIA의 전략 방향성이 디바이스와 부품 전반의 방향성을 결정할 전망
- NVIDIA가 원하는 첫 번째, All in One. 에이전트 개화 과정에서 기존 디바이스(PC)는 1) 메모리 용량 부족, 2) CPU↔GPU 병목 발생
→ 서버 외 에이전트용 PC(RTX Spark)까지 생태계 확장. 향후 에이전트용 소비자 수요는 PC와 로컬 서버로 나뉠 수 있으나 로컬 서버 라인업(DGX Spark)도 기보유
- NVIDIA가 원하는 두 번째, 1+1=3. GPU 확대의 단기 어려움을 1) 연산 과정을 쪼개고, 2) 새로운 보완재 하드웨어를 늘리는 방식을 통해 해결
- CPU/DPU→CPO→HBF 순으로 하드웨어 기회요인 확대. 해당 흐름에서 공통 조건은 '메모리 증가'이며, 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 비중확대 지속 유효한 국면

● 전기전자: AI 랙 고도화가 이끄는 전력·냉각 생태계의 확장 | 관심업종: 국내 수동부품 / 냉각 / 기판 밸류체인(Top-Pick 삼성전기)

- Computex 2026의 핵심 화두는 전력·냉각 인프라. AI 랙 전력밀도가 상승하면서 전력 공급, 전력 안정화, 열 관리가 핵심 병목으로 부상
- NVIDIA가 AI Factory를 칩·랙·네트워크·전력·냉각·그리드가 결합된 통합 인프라로 제시하면서, AI 생태계가 전력·냉각·부품 업체까지 확장되는 흐름 확인
- 전력 부문에서는 800V HVDC 전환이 본격화. Power Rack, BBU, DC/DC Shelf, Bus Bar, Power Capacitance Shelf 등 신규 제품군이 구체화
- 냉각 부문에서는 D2C 액체냉각의 표준화 뚜렷. CDU·매니폴드·QD·콜드플레이트 등 랙 단위 냉각 부품 생태계가 세분화되는 흐름
- 기판은 이번 Computex 메인은 아니었으나, AI 서버 고집적화와 고속 인터커넥트 확대 방향성은 여전히 유효. 고성능 기판 수요는 구조적 성장축으로 유지될 전망
- 국내 투자 유망 업종으로 고전압 수동부품 / 냉각 장비·부품 / 기판 밸류체인을 제시. Top-Pick 삼성전기

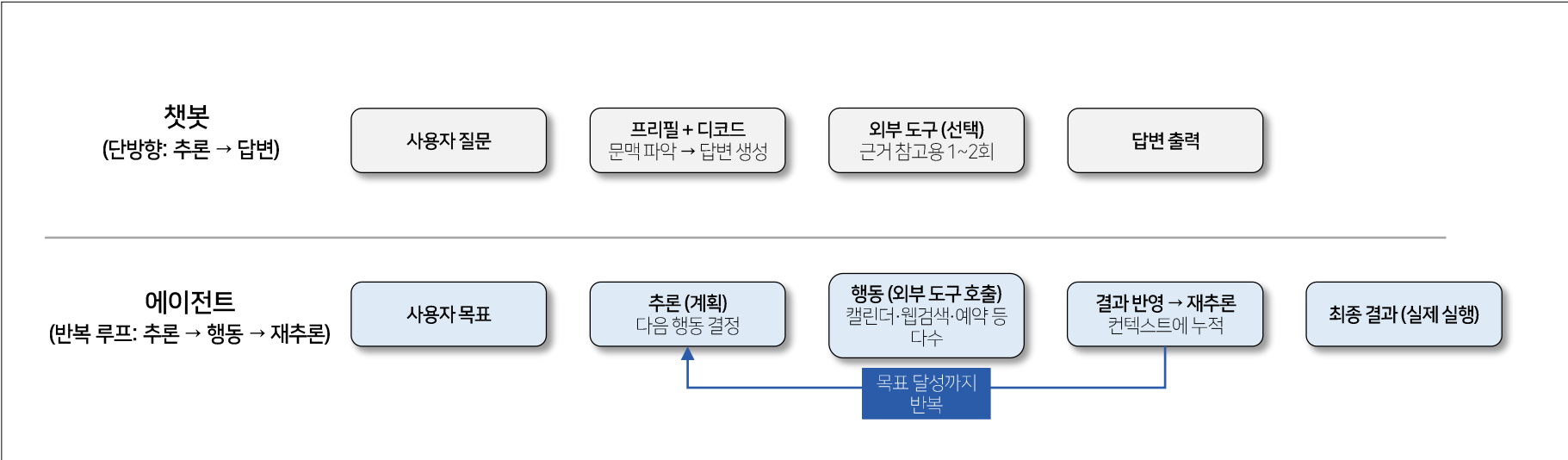
II. 반도체

II. 반도체 1. Intro) AI 모델 기술 변화가 말해주는 것

에이전트 시대 개막

- 챗봇에 이어 에이전트, Physical AI로 확장
- 에이전트, Physical AI로 확장되는 과정에서의 기술 방향성은 2가지
 - 1) 외부도구 사용량 증가: GPU의 연산 과정에서 재료가 되는 외부도구 활용량 증가
 - 2) 반복 루프 증가: 추론 → 행동 → 재추론의 반복 연산 횟수가 늘어날수록 정확도 및 연산 결과 퀄리티 향상

에이전트 연산 과정

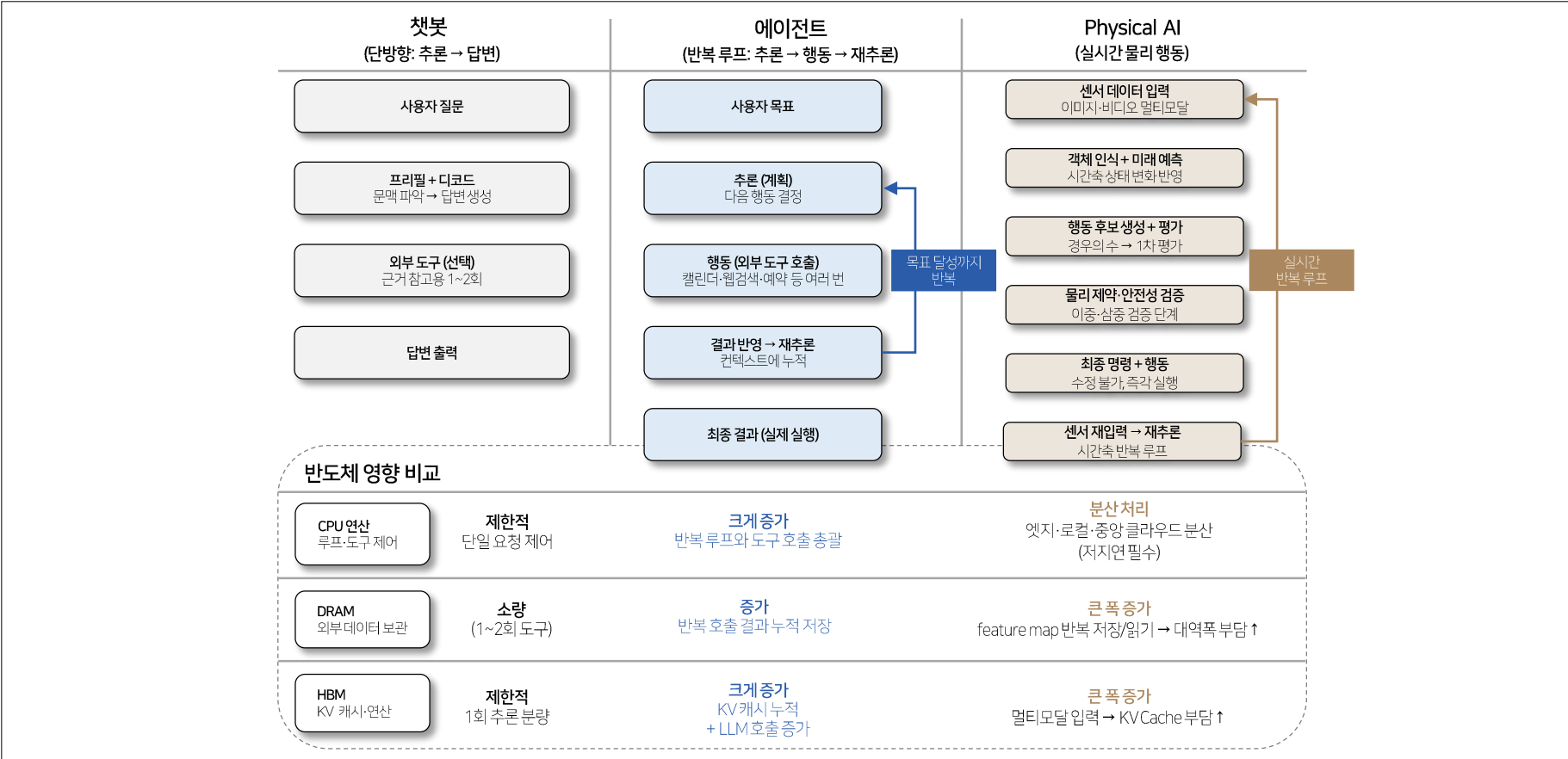


Source: NVIDIA, 다올투자증권

II. 반도체 1. Intro) AI 모델 기술 변화가 말해주는 것

외부도구 호출과 반복 루프 연산 증가

추론 연산 비교: 챗봇 vs 에이전트 vs Physical AI



Source: 다올투자증권

II. 반도체 1. Intro) AI 모델 기술 변화가 말해주는 것

연산의 다다익선, 빅테크 투자 비용을 생태계가 분담

- LLM을 보유한 것이 주도권? 더 이상 아닌 구조
 - 에이전트와 Physical AI용 파운데이션 모델, NVIDIA를 중심으로 오픈 소스로 무료 배포
 - NVIDIA의 에이전트용 Nemotron, Physical AI용 Cosmos가 대표적
- 성능 결정 변수 이동: 과거 성능 결정 변수는 LLM(파운데이션 모델) 개발 기술력 & 자본력 → 현재는 반복 루프 연산의 횟수
 - 다수의 연산 비용을 지불할 수 있는 자본력만 있다면 산업 진입 가능
 - 생태계 전반이 빅테크의 데이터센터(연산 인프라)를 사용 → 빅테크의 인프라 투자 비용을 사실상 생태계가 분담하는 구조

성능 결정 변수가 연산의 다다익선으로 이동



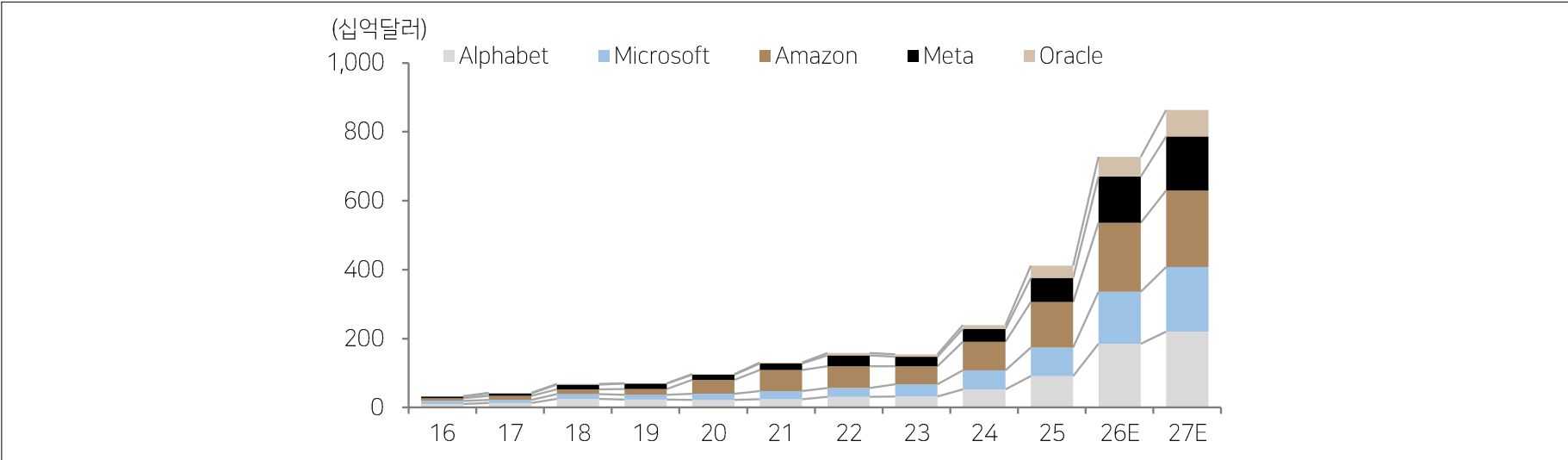
Source: 다올투자증권

II. 반도체 1. Intro) AI 모델 기술 변화가 말해주는 것

빅테크의 목표, 연산은 더 많이 & 하드웨어는 더 적게

- 더 이상 중기 CapEx 증가에 대한 우려는 불필요
 - 생태계 전반이 빅테크의 AI 인프라 구축 비용을 실질적으로 분담하는 양상일 전망
- AI 모델 기술 방향성이 얘기하는 것, 반복 루프 확대 = GPU 확대
 - 그러나 GPU를 무조건 늘린다? 비용 부담과 기술 부담 동시 발생
 - 목표는 GPU를 덜 늘려도 마치 GPU를 많이 늘린 것과 같은 결과를 만들어내는 것

빅테크 CapEx 추이 및 전망



Source: Bloomberg, 다올투자증권

II. 반도체 2. NVIDIA가 원하는 것 - ① All in One

에이전트가 유발하는 디바이스 생태계 변화

- 개인형 에이전트 서비스 확대 중, 기존 디바이스 구조에는 한계점 존재
 - 1) 메모리 용량 부족: 유의미한 에이전트 구동을 위해서는 최소 RAM 128GB 수준 필요
 - 2) 연산 연결 병목: CPU↔GPU 연산 중 데이터 이동 증가 과정에서 병목 발생
- NVIDIA, 에이전트 최적화 AI PC용 플랫폼/시스템 칩인 RTX Spark 출시 발표
 - 기존 PC와의 대표적 차이점은 1) RAM 용량 확대, 2) CPU와 GPU의 메모리가 분리형이 아닌 통합형, 3) PCIe가 아닌 NVLink 구조 채택
 - Microsoft와 함께 협력, 근간은 PC이지만 로컬로 에이전트를 돌리는 것에 무리가 없는 디바이스를 추구

NVIDIA RTX Spark와 기존 AI PC 비교

구분	기존 AI PC / RTX 노트북	RTX Spark
CPU-GPU 연결	주로 PCIe	NVLink-C2C
메모리 구조	시스템 RAM + GPU VRAM 분리	최대 128GB 통합 메모리
모델 크기 제약	VRAM 용량에 크게 연동	더 큰 메모리 풀 활용 가능
데이터 이동	CPU-GPU 복사 비용 큼	더 긴밀한 CPU-GPU 결합
에이전트 적합성	작은/중간 모델 중심	대형 로컬 에이전트에 더 유리

Source: NVIDIA, 각 사, 다올투자증권

II. 반도체 2. NVIDIA가 원하는 것 - ① All in One

소비자의 선택, RTX Spark(AI PC) vs DGX Spark(로컬 서버/슈퍼 컴퓨터)

- 에이전트용 디바이스는 RTX Spark 만 가능한 것이 아니라 DGX Spark도 대안
 - 기본 구조는 유사, 자체 CPU(Grace, Vera) + GPU(Blackwell, Rubin) + 통합 메모리 + NVL C2C로 구성
 - 차이점은 RTX Spark는 구성 칩, DGX Spark는 PC 완제품 자체(내부 칩은 GB10)라는 것
- 기능적 차이는 PC를 기반으로 에이전트 구동 목적성을 가진 RTX vs 전문 에이전트 구동 서버인 DGX
 - RAM 128GB 등 RTX Spark 탑재 PC 가격은 기존 PC 대비 크게 높아질 가능성 → DGX 가격(\$4,699)과 비교했을 때 성능 대비 비용 차이가 어느정도 일지가 관건

NVIDIA RTX Spark와 DGX Spark 비교

구분	RTX Spark	DGX Spark
제품 형태	Windows AI PC용 플랫폼 / 슈퍼칩	데스크톱 AI 슈퍼컴퓨터 완제품
핵심 칩	Blackwell RTX GPU + 20코어 Grace CPU	GB10 Grace Blackwell Superchip
AI 성능	최대 1 PFLOP FP4	최대 1 PFLOP FP4
메모리	최대 128GB 통합 메모리	128GB LPDDR5x 통합 메모리
주요 용도	로컬 AI, 크리에이티브, 게임, Windows 기반 개발	로컬 LLM 추론, 파인튜닝, AI 개발
모델 처리 규모	120B LLM, 최대 100만 토큰 컨텍스트 언급	최대 200B 추론, 70B 파인튜닝
폼팩터	노트북·소형 데스크톱	소형 데스크톱, 1.2kg
소프트웨어	Windows, CUDA, RTX AI 스택	DGX OS, NVIDIA AI 소프트웨어 스택
가격	미공개 / OEM별 상이	\$4,699

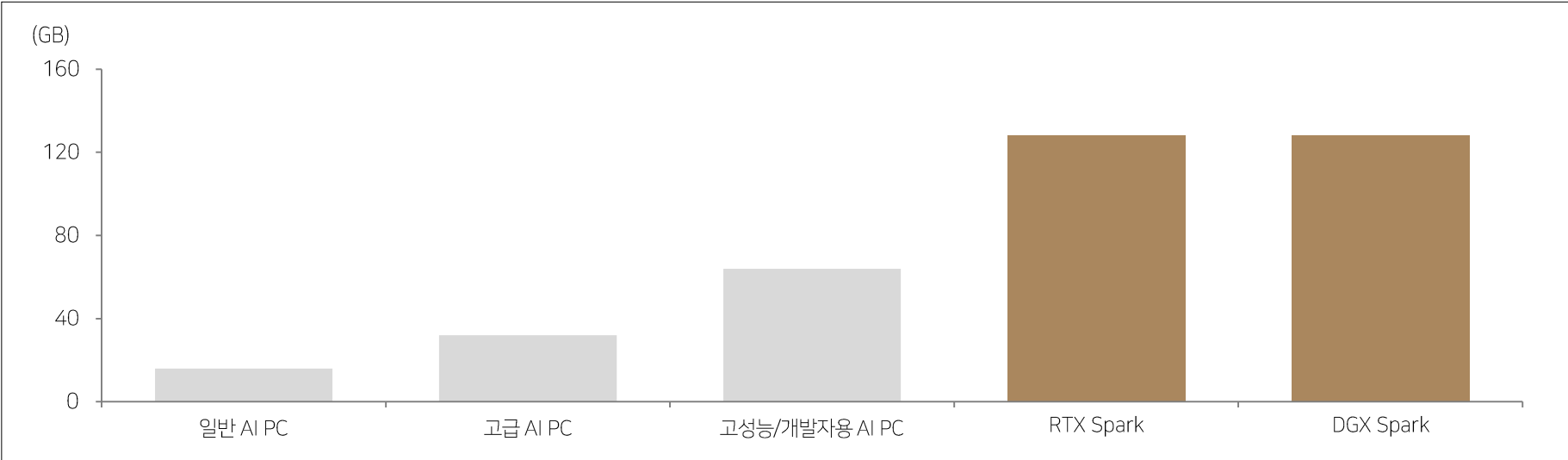
Source: NVIDIA, 다올투자증권

II. 반도체 2. NVIDIA가 원하는 것 - ① All in One

세트의 확장은 분명하다

- 에이전트 구동 관점에서 PC의 고도화 또는 로컬 서버 사용 비율의 증가는 기술적으로 나타날 가능성이 높은 상황
 - 고도화된 PC를 높은 가격을 주고 사용하거나, 현재와 같은 PC 수준을 사용하며 동시에 개별 로컬 서버를 두고 클라우드로 활용하거나 2가지 시나리오
- 어떠한 경우를 가정하더라도 세트의 확장 효과는 분명
 - 신규 메모리 수요 효과 기대
 - NVIDIA는 어떤 경우라도 커버 가능한 생태계 범위 확장 달성 → AI 연산 생성 주체(데이터센터)부터 사용 주체(디바이스)까지 한번에 아우르는 구조

PC 및 로컬 서버 RAM 용량 비교



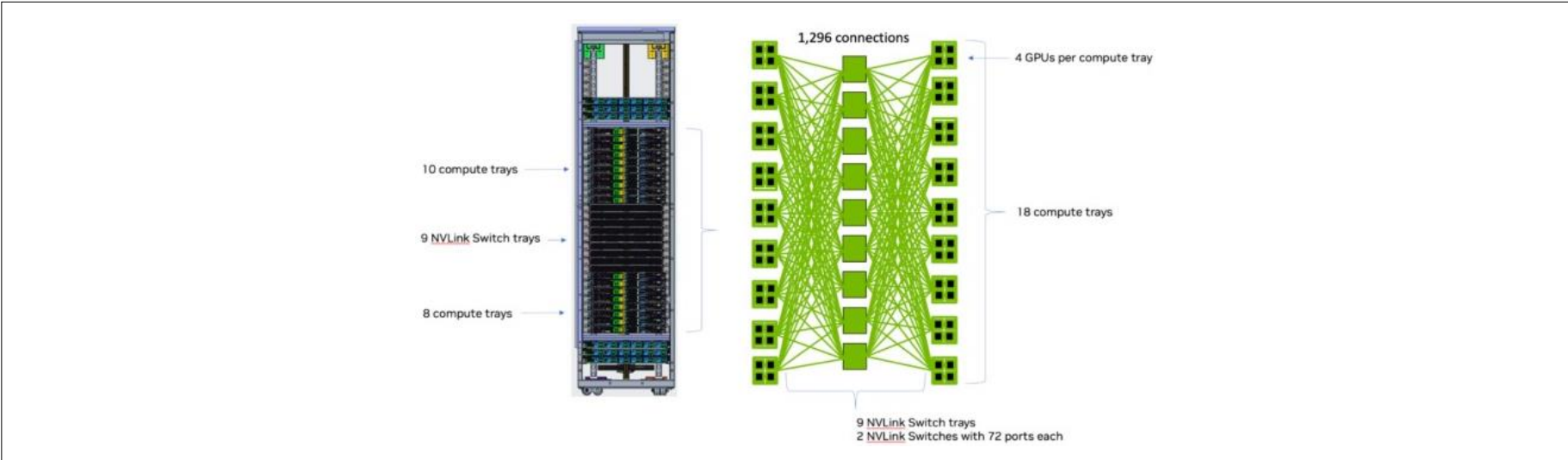
Source: 다올투자증권

II. 반도체 3. NVIDIA가 원하는 것 - ② 1±1 = 3

NVIDIA의 고안, 쪼개고 늘리고

- 반복 루프 확대에 따른 GPU 연산 규모 증가, 그러나 GPU를 무조건 늘리기엔 비용 & 기술 측면 부담 존재
 - 랙 구조의 장점은 유기적 연결성 → 대신 반대로 정해진 구조 이상의 GPU 확장은 기술적 난이도 급증
- NVIDIA가 택한 방법은 쪼개고, 늘리고
 - GPU의 Q가 증가하지 않아도 마치 Q가 증가하는 것과 같은 효과 만들기
 - 연산 과정에서 역할을 쪼개거나, 새로운 보완재 하드웨어를 늘려 GPU 연산 효과(Utilization) 극대화

NVIDIA GB200 구조



Source: NVIDIA, 다음투자증권

II. 반도체 3. NVIDIA가 원하는 것 - ② 1±1 = 3

1차 보완재 하드웨어, CPU

- 외부도구 호출 횟수(CPU)가 늘어나는 에이전트 & Physical AI, GPU 가동률 저하 요인 → CPU 병목 해소 만으로도 GPU 가동률 극대화
- NVIDIA의 에이전트 특화 차세대 CPU Vera, 단순 CPU의 의미보다 AI 연산 과정에서 CPU 병목을 줄이기 위한 특수 목적 기반 설계
 - 1) Spatial Multithreading: 코어당 동시 실행 가능한 스레드 개수를 늘려 일종의 코어 가동률을 높이는 기술 → 메모리 대기 시간을 줄이고 최대한 활용
 - 2) SCF(Scalable Coherency Fabric) & Rubin GPU와 NVLink-C2C: SCF는 데이터 이동 고속 연결망으로 여타 CPU 대비 GPU와의 연결성에 대해 사전 고려 → 이전 CPU인 Grace와 달리 자체 코어(Olympus)를 사용해 위 기술들을 통합 설계할 수 있는 구조
 - 3) SOCAMM2: 저전력 & 고대역폭 동시에 목표할 수 있는 탈부착 메모리

NVIDIA Vera CPU 주요 스펙

기술 구조	Vera CPU	Grace CPU	EPYC 9005 / Xeon 6
CPU 코어 설계 철학	NVIDIA가 에이전트 AI와 GPU 공급 병목을 보고 직접 설계한 Olympus 코어	Arm Neoverse V2 기반 고효율 서버 CPU	범용 서버 성능, 호환성, 클라우드·엔터프라이즈 최적화
멀티스레딩	Spatial Multithreading으로 코어당 2개 실행 흐름	코어당 1스레드 성격	EPYC는 SMT, Xeon은 제품군별 상이
메모리 설계	LPDDR5X/SOCAMM으로 고대역폭·전력 효율 중시	LPDDR5X 온모듈 메모리	DDR5/MRDIMM 중심, 범용 서버 확장성 중시
내부 패브릭	SCF가 코어·캐시·메모리·I/O·NVLink-C2C를 연결	SCF 계열로 CPU/GPU 결합 지원	Infinity Fabric 또는 Mesh가 CPU 내부 확장성 담당
GPU 연결	NVLink-C2C로 Rubin GPU와 coherent 강결합	NVLink-C2C로 NVIDIA GPU와 강결합 가능	대체로 PCIe/CXL 기반 외부 가속기 연결
메모리 모델	CPU LPDDR5X-SOCAMM2와 GPU/HBM과 긴밀한 구조	Grace Hopper/Blackwell에서 CPU-GPU 메모리 결합	CPU DRAM과 GPU HBM이 상대적으로 분리된 구조
에이전트 루프 최적화	CPU 작업, GPU 왕복, KV-cache, 오케스트레이션 최적	GPU 호스트 CPU로 고효율	GPU 연결보다 범용 CPU 처리량과 호환성 중심

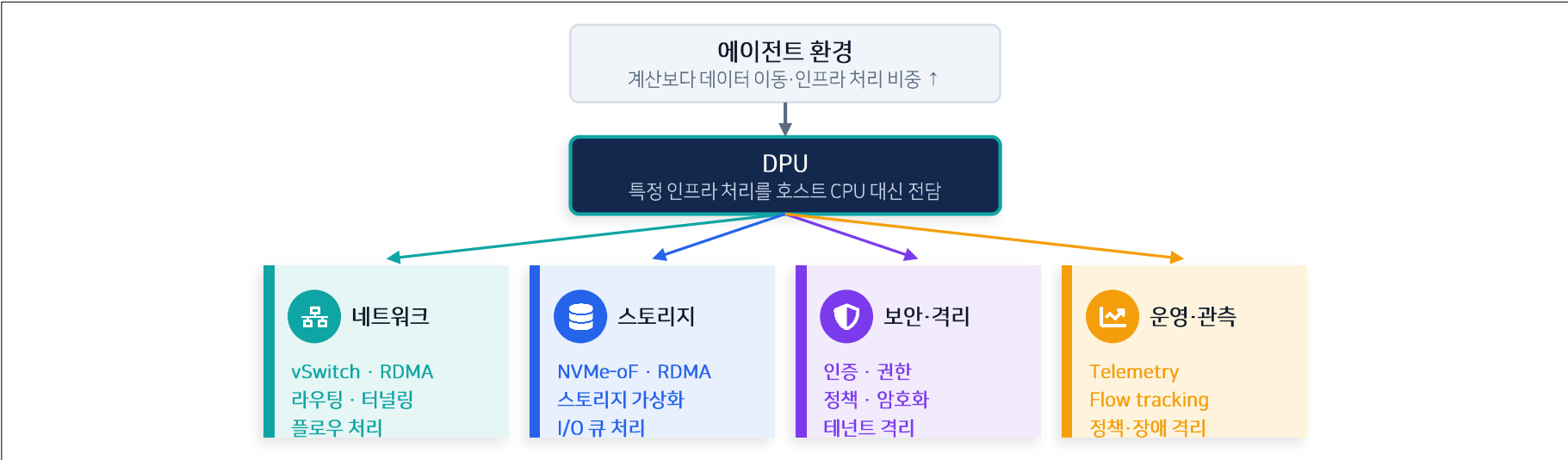
Source: NVIDIA, 다올투자증권

II. 반도체 3. NVIDIA가 원하는 것 - ② 1±1 = 3

CPU 역할 쪼개기, DPU

- NVIDIA, CPU에 가해지는 부담 강도 축소를 위해 BlueField 도입
 - DPU(Data Processing Unit) 제품으로 네트워킹, 스토리지, 보안 등을 전용 하드웨어와 내장 Arm CPU로 처리하는 인프라 가속 장치
 - 일반 서버에서는 CPU가 가상 스위칭, 암호화, 방화벽, 스토리지 I/O, 모니터링 같은 인프라 작업도 함께 처리
 - BlueField가 해당 역할을 대부분 수행하며 CPU가 나머지 에이전트 작업에 더 집중할 수 있는 환경 조성, GPU 가동률 극대화
- 에이전트 환경에서 외부도구 호출 등 데이터 이동량 증가
 - DPU가 처리할 수 있는 일 확대 → 메모리 증가

에이전트 시대에서 DPU의 역할



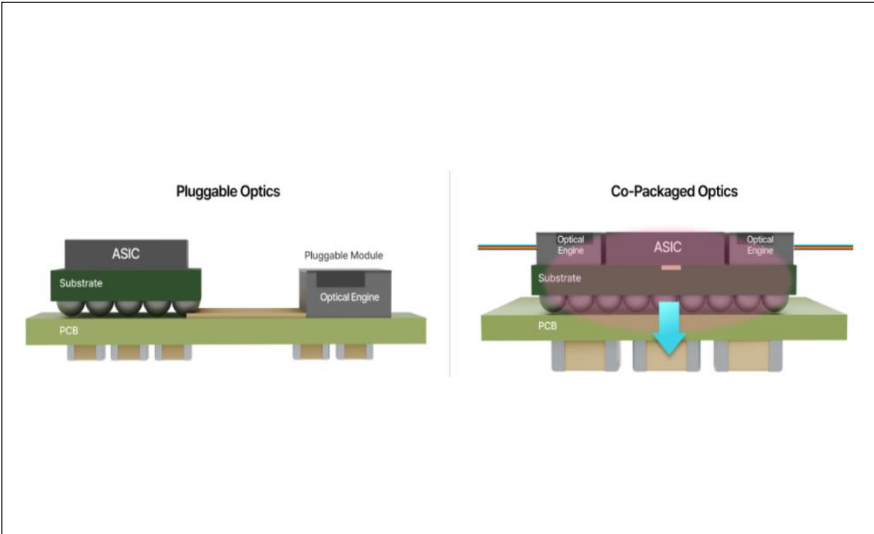
Source: 다올투자증권

II. 반도체 3. NVIDIA가 원하는 것 - ② 1±1 = 3

2차 보완재 하드웨어, CPO

- GPU 개수를 늘리지 않고 연산 성능을 끌어올릴 수 있는 두 번째 방법은 연결 지연의 최소화
 - AI 모델 고도화 과정에서 여러 GPU가 동시에 구동 필요 → 랙 구조(스케일업)를 통해 유기적 연결을 달성
 - 유기적 연결에서 어려움은 전력, 냉각 등 시스템 전체를 하나로 통합하는 과정에서의 높은 기술 난이도
 - 그 이상의 GPU 연결이 필요한 경우 단기적으로 우선적 방법은 스케일아웃으로 확장하는 것
- 스케일아웃 전송 속도 지연 최소화를 위한 방법이 CPO(Co-Packaged Optics)

CPO 구조도



Source: 삼성전기, 다올투자증권

CPO 주요 업체별 로드맵

업체	제품/플랫폼	도입 시점
NVIDIA (Scale-out)	Spectrum-X / Spectrum-6 102T CPO	26년 하반기
NVIDIA (Scale-out)	Quantum-X (Infiniband)	26년 중
Broadcom	Tomahawk 6 102.4T CPO (3nm)	26년 중
NVIDIA (Scale-up)	NVLink 8 CPO + Spectrum-7 204T	28년 (Feynman 세대)
AMD	MI500 + GlobalFoundries CPO	28년 중

Source: 각 사, 다올투자증권

II. 반도체 3. NVIDIA가 원하는 것 - ② 1±1 = 3

3차 보완재 하드웨어, HBF

- CPO 도입 이후에 추가적인 연산 성능 극대화가 가능한 세 번째 방법은 HBF(High Bandwidth Flash)
 - KV Cache 저장 공간은 HBM. Hot KV Cache 뿐 아니라 Cold KV Cache까지 저장돼 있을 경우 HBM 용량 부족으로 연결 → 연산속도 지연 및 GPU 활용률 저하
 - Cold KV Cache 저장 공간을 HBF에서 분담하면 HBM 공간 여유와 함께 GPU 연산 극대화 가능
- 다만 도입 시기는 CPO까지 도입된 이후
 - 주요 빅테크의 CPO 도입이 진행될 28년 이후가 HBF 시장 개화 시점으로 유력

HBM vs HBF 구조 비교



Source: Sandisk, 다올투자증권

HBF 주요 업체별 로드맵

업체	제품/플랫폼	도입 시점
Kioxia	5TB 프로토타입	25.08 공개
SanDisk + SK하이닉스	1세대 HBF 샘플	26년 하반기
	AI 추론 디바이스 적용	27년 초
	HBF 본격 확산	30년 이후
삼성전자	컨셉 설계 단계	TBD

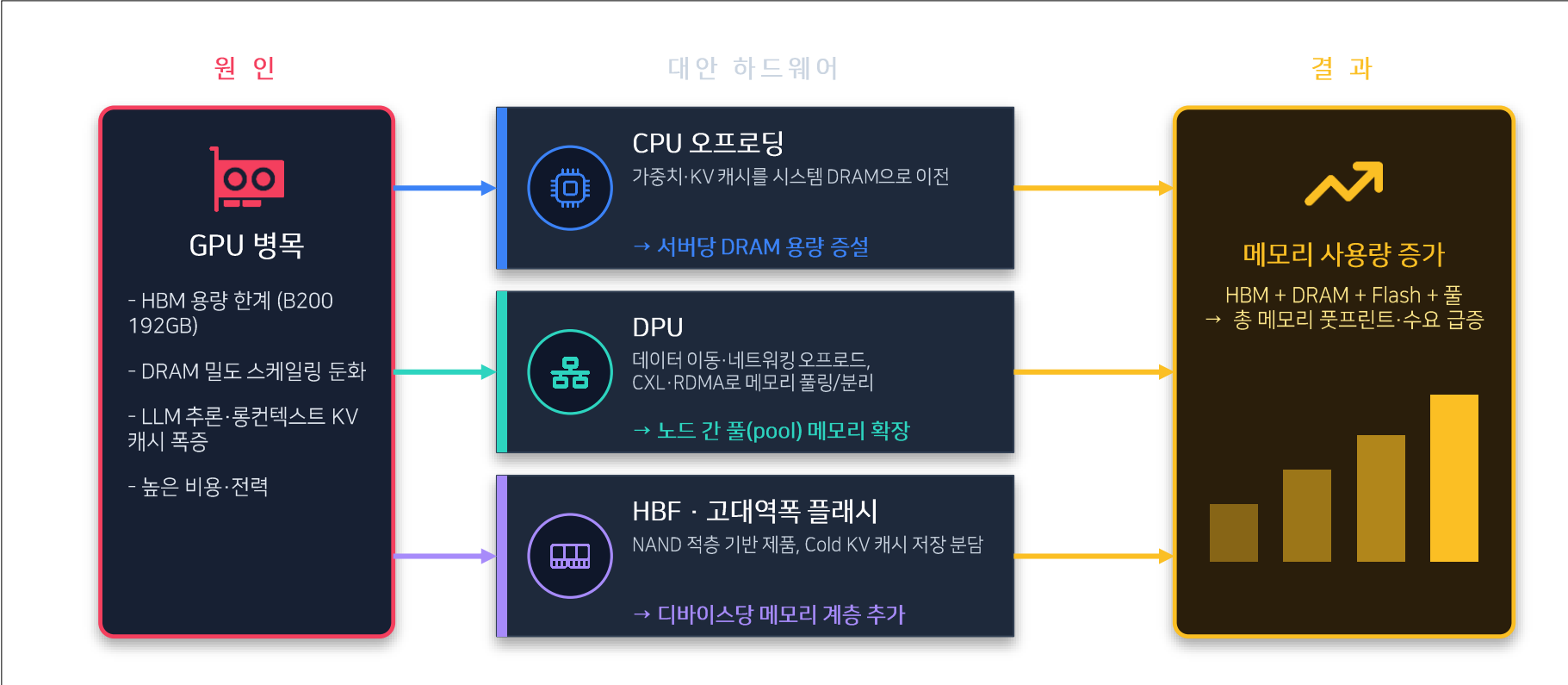
Source: 각 사, 다올투자증권

II. 반도체 3. NVIDIA가 원하는 것 - ② 1±1 = 3

모든 것이 동일하게 가리키는 것, 결국 메모리 증가

- GPU 확장에 대한 대안인 CPU, DPU, CPO, HBF 중 CPO를 제외하면 모두 직접적인 메모리 사용량 증가 유발

NVIDIA 주요 플랫폼 라인업



Source: 다올투자증권

II. 반도체 3. NVIDIA가 원하는 것 - ② 1±1 = 3

NVIDIA의 목표, 모든 길은 NVIDIA로

- 기존 생태계 확장 흐름: GPU(H/W) → Cosmos/PhysicsNemo 등(S/W) → DGX Cloud(CSP)
 - 소프트웨어 및 최종 연산 자체에 대한 락인을 통해 근간인 GPU 생태계를 공고히 유지하는 전략
- 여기에 추가 확장은 DSX, AI Factory 전체 인프라 스택을 설계·구축·운영하기 위한 레퍼런스 디자인을 의미
 - 단순 하드웨어, 소프트웨어 공급을 넘어 통합 기술 난이도가 높은 전력, 냉각 등 인프라 전반의 솔루션을 제공하려는 계획
 - 궁극적으로 NVIDIA의 목표는 연산 임대만 원하는 고객에게는 클라우드 서비스(DGX Cloud)를, 자체 인프라 구축을 원하는 고객에게는 물리적 시설 구축 노하우 통합 제공 → 생태계가 유기적으로 연결되는 것이 중요

NVIDIA 생태계 확장



Source: 다올투자증권

II. 반도체 3. NVIDIA가 원하는 것 - ② 1±1 = 3

NVIDIA가 갖춘 풀스택 기반 시너지 구조

NVIDIA 주요 제품군 라인업



Full-Stack 기반 · 하드웨어 + 소프트웨어

하드웨어 제품군 (Hardware)

컴퓨터 칩	Rubin GPU · Vera CPU · Blackwell · Grace
시스템·랭	DGX · HGX · NVL72 · SuperPOD · DGX Spark
네트워킹	NVLink · Quantum InfiniBand · Spectrum-X · BlueField DPU
엣지·차량	Jetson Thor · IGX · DRIVE Thor · RTX PRO · GeForce

소프트웨어 기술 (Software)

기본 플랫폼	CUDA
가속 라이브러리	CUDA-X (cuDNN · TensorRT · cuOpt · RAPIDS)
AI 학습·추론	NeMo · TensorRT-LLM · Triton · Dynamo · NIM
도메인 SW	Cosmos · Isaac · DRIVE · Omniverse · Clara · Earth-2 · Aerial
운영·오케스트레이션	AI Enterprise · Base Command · Run:ai · Mission Control

Source: 다올투자증권

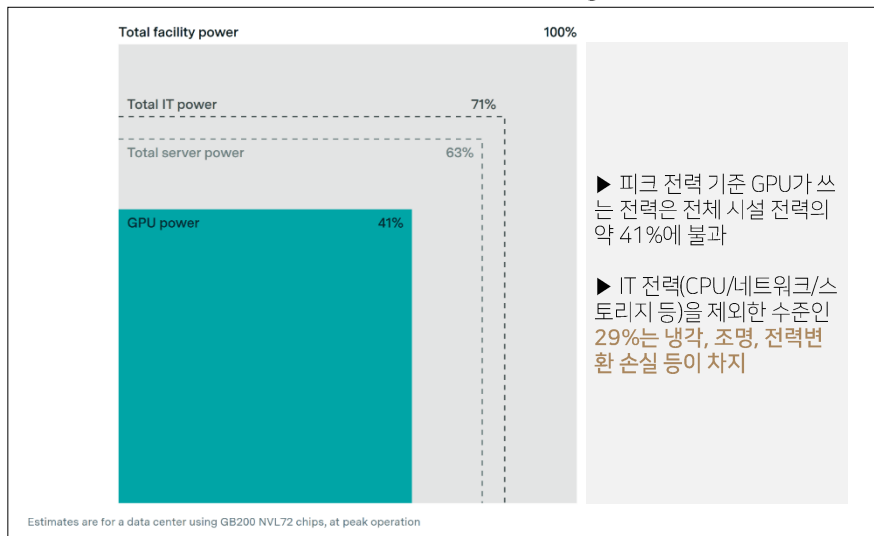
III. 전기전자

III. 전기전자 1. 칩 밖으로 번지는 AI 인프라 혁신

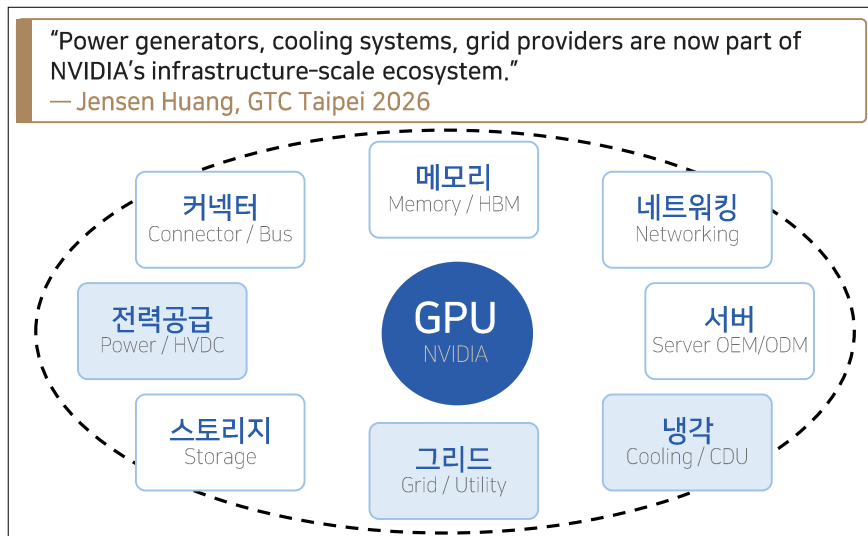
칩을 넘어 시스템으로: AI 인프라 범목의 재분배

- AI 경쟁은 단일 칩 성능에서 시스템 레벨로 확장. 차세대 랙으로 갈수록 전력밀도와 발열이 급증하면서, 전력 공급·전력 안정화·냉각이 AI DC의 핵심 범목으로 부상
 - NVIDIA는 금번 행사에서 AI Factory를 단순 서버 클러스터가 아니라 칩, 랙, 네트워크, 전력, 냉각, 그리드를 함께 설계해야 하는 통합 인프라 플랫폼으로 제시
 - Computex 2026에서는 800V HVDC 파워랙, 액침냉각 BBU, 버스바, CDU/매니폴드/콜드플레이트 등 전력·냉각 관련 제품이 대거 공개
- AI 인프라 투자의 무게중심이 칩 단품에서 랙 단위 전력·열 관리 솔루션으로 이동 중

AI 데이터센터 전력 소비 비중



NVIDIA 생태계 편입 맵: GPU 중심에서 인프라 전반으로 확장



Source: Epoch AI, 다올투자증권

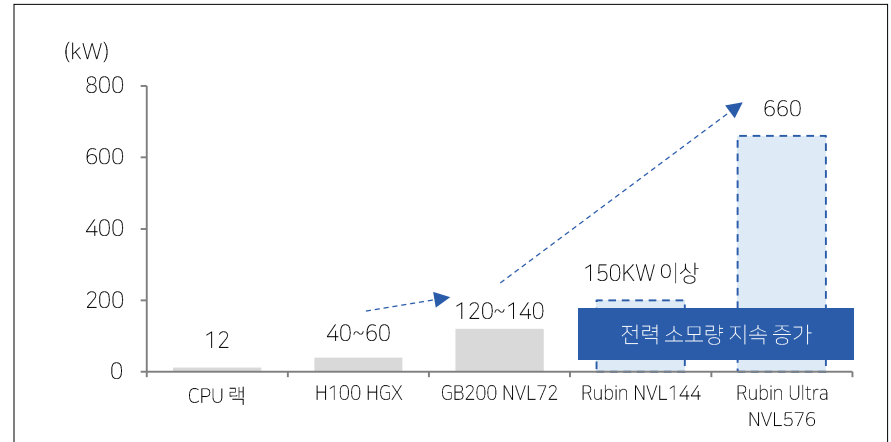
Source: 다올투자증권

III. 전기전자 1. 칩 밖으로 번지는 AI 인프라 혁신

랙 전력밀도 상승이 생태계 확장의 Prime Mover

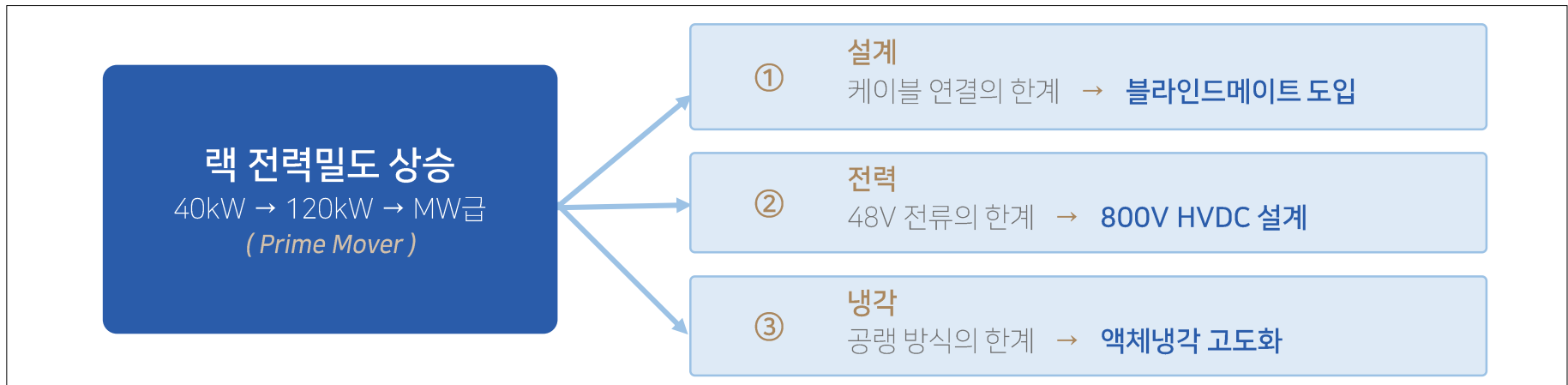
- 랙당 전력이 40kW → 120kW → MW급으로 점프
- 랙은 단순 서버 집합이 아니라 전력·열·인터커넥트를 통합한 새시로 진화
- 변화가 가시적으로 드러나는 3대 지점:
 - ① 케이블 프리 랙 설계 요구 → 블라인드메이트 도입
 - ② 48V 전류 시스템의 한계 → 800V HVDC 설계 도입
 - ③ 공랭의 한계 → 액체냉각 고도화
- 즉, 전력밀도 상승이 설계·전력·냉각 전반의 재설계를 동시에 촉발

세대별 랙 소비전력



Source: NVIDIA, 언론종합, 다올투자증권

랙 전력밀도 상승이 촉발하는 3대 설계 변화



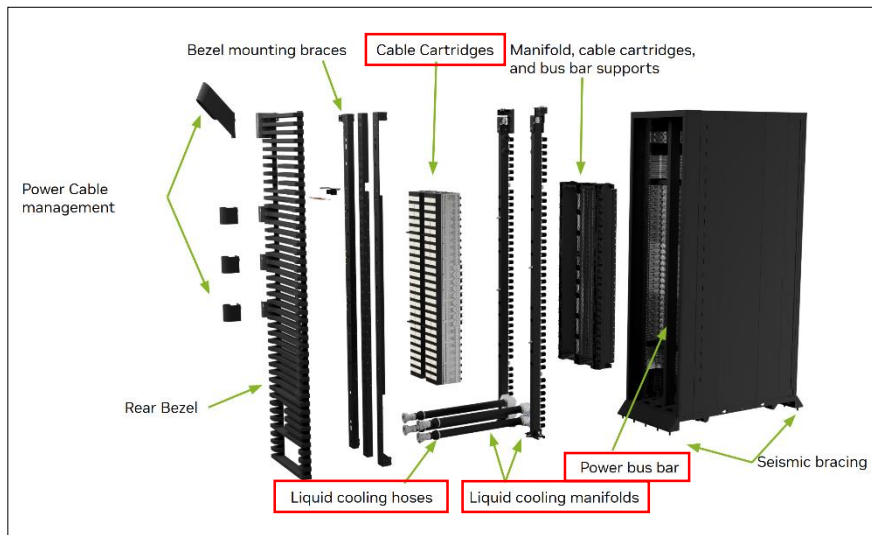
Source: 다올투자증권

III. 전기전자 1. 칩 밖으로 번지는 AI 인프라 혁신

블라인드메이트: 케이블 프리 랙의 표준화

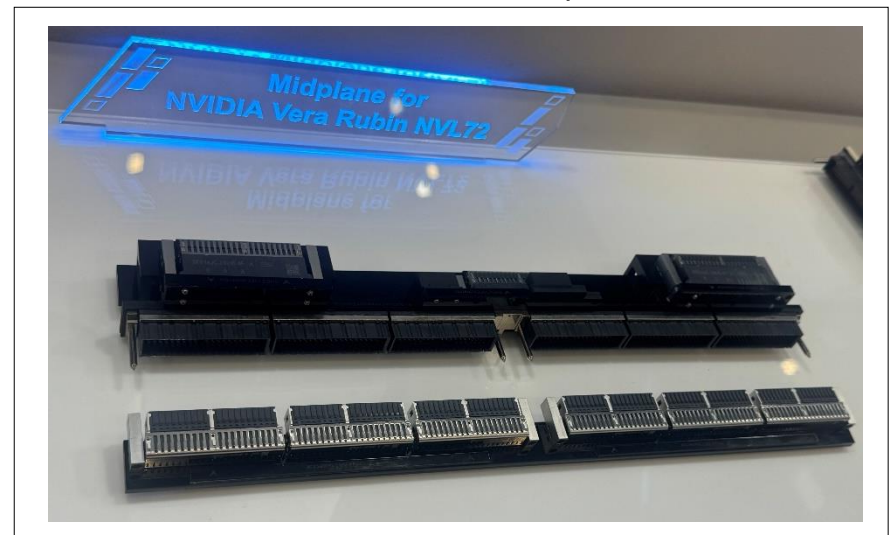
- NVIDIA VR NVL72부터 서버 트레이를 꽂으면 전력/냉각/고속 인터커넥트가 후면에서 자동 정렬·체결되는 블라인드메이트 구조 도입
- 랙 전력밀도 상승으로 전력 케이블, 냉각 호스, 신호 케이블 수가 급증하면서, 개별 수작업 연결 방식은 조립·정비 시간과 오류 리스크 측면에서 한계
- 블라인드메이트 구조는 전력은 버스바(bus bar), 냉각은 매니폴드(manifold)/QD, 신호는 Midplane으로 모듈화해 랙 단위 조립성과 서비스성을 개선
- GPU 트레이 교체·정비 빈도가 높아질수록 빠른 탈착 구조는 데이터센터 TCO 절감과 다운타임 축소로 연결

트레이 후면 블라인드메이트 구조



Source: NVIDIA, 다음투자증권

NVIDIA VR NVL72용 Midplane



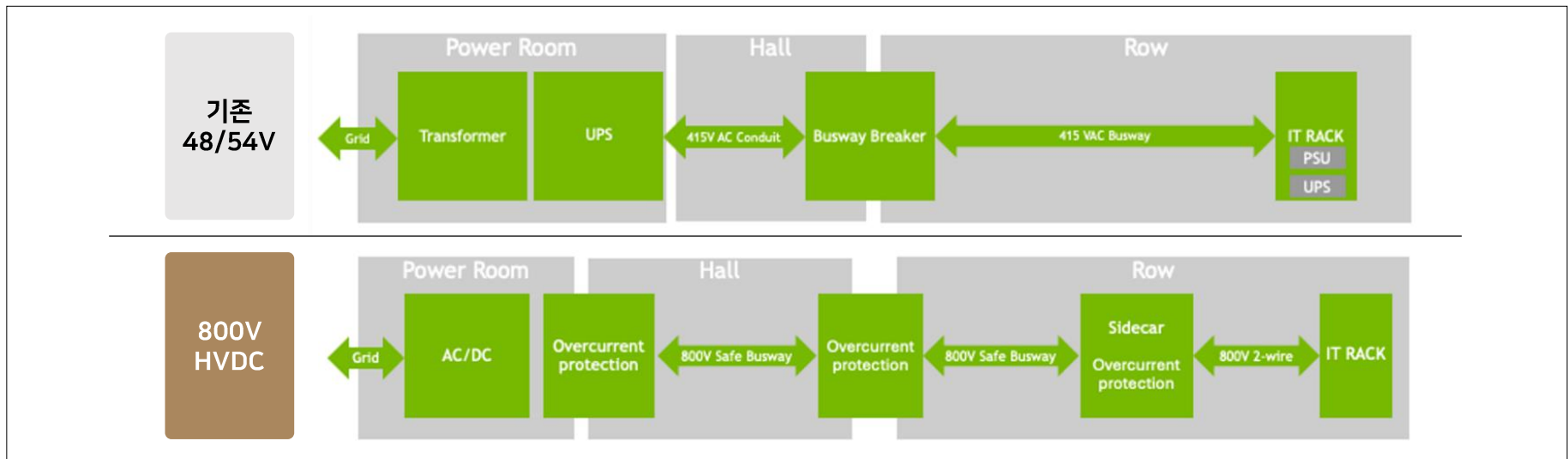
Source: FOXCONN, 다음투자증권

III. 전기전자 2. 전력: 800V HVDC 랙의 본격 등장

800V HVDC는 고전력 AI 랙의 필수 인프라

- 기존 AI 서버 랙은 데이터센터의 AC 전력을 UPS/PDU를 거쳐 서버 랙으로 공급한 뒤, 랙 내부에서 48V/54V DC로 변환해 전력을 분배하는 구조가 일반적
- 랙 전력이 수백kW에서 MW급으로 상승하면서 48V 기반 구조에서는 동일 전력을 보내기 위해 필요한 전류가 과도하게 커짐
→ 이에 따라 구리 배선·버스바 면적, 발열, 전력 손실, 랙 내부 공간 부담이 급격히 증가
- 800V HVDC(High Voltage Direct Current)는 랙 또는 데이터센터 전력망을 고전압 DC 기반으로 재설계해 전류를 크게 낮추는 방식으로, 차세대 전력 아키텍처로 부상

기존 48/54V 배전 및 800V HVDC 배전 구조 비교



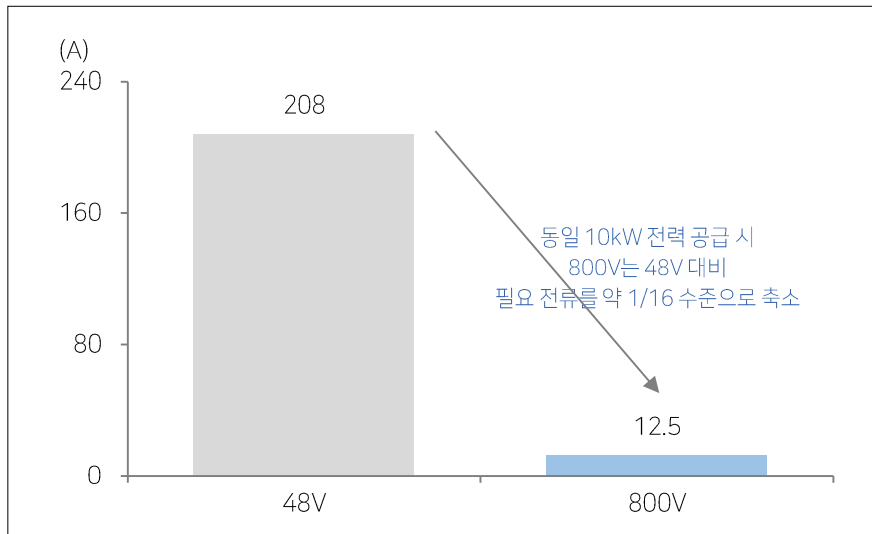
Source: NVIDIA, 다올투자증권

III. 전기전자 2. 전력: 800V HVDC 랙의 본격 등장

800V 전환의 핵심 효과: 전력 변환단 축소

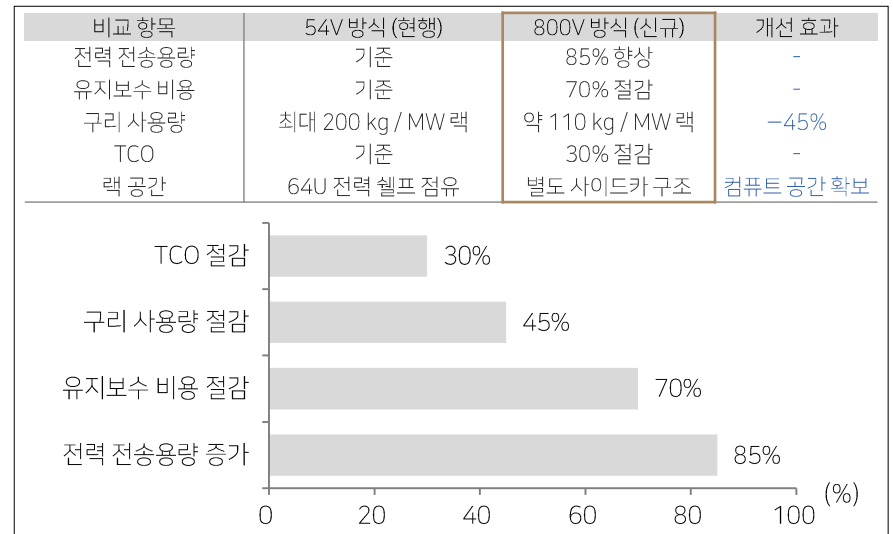
- 800V HVDC는 데이터센터 경계에서 AC를 800V DC로 직접 변환한 뒤, 랙까지 고전압 DC를 배전하는 구조
- 기존 구조에서 랙 내부 또는 중간 전력단에 분산되어 있던 AC/DC 변환과 UPS·PDU 중심의 복잡한 전력 경로를 줄여, 전력 전달 구조를 단순화
- 전압을 높이면 동일 전력 공급에 필요한 전류가 낮아지기 때문에, 배선·버스바·커넥터의 구리 사용량과 I²R 손실, 발열 부담을 동시에 감축 가능

동일 전력 공급 시 48V 대비 800V의 전류 감소 효과



Source: 다올투자증권

800V HVDC 전환에 따른 효율·비용 개선 효과



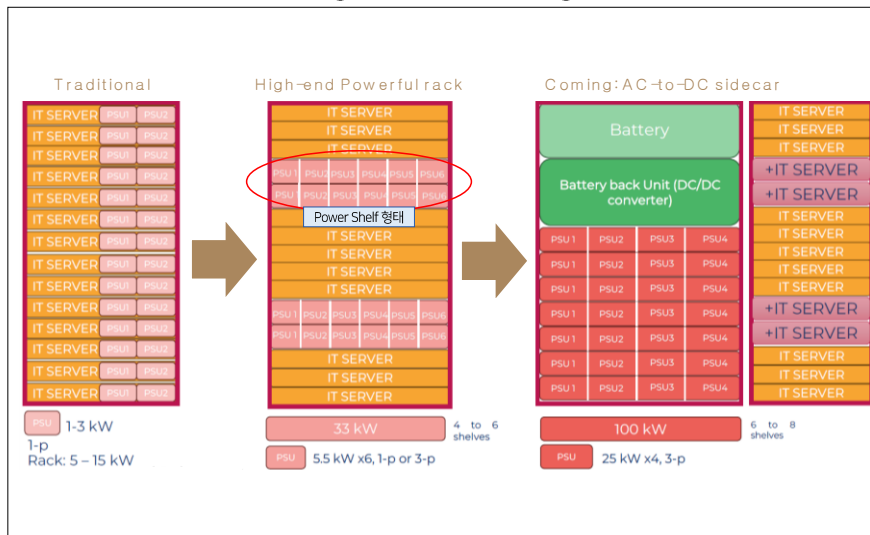
Source: NVIDIA, 다올투자증권

III. 전기전자 2. 전력: 800V HVDC 랙의 본격 등장

800V 파워랙의 구성: 전력변환·백업·분배 기능의 랙 단위 통합

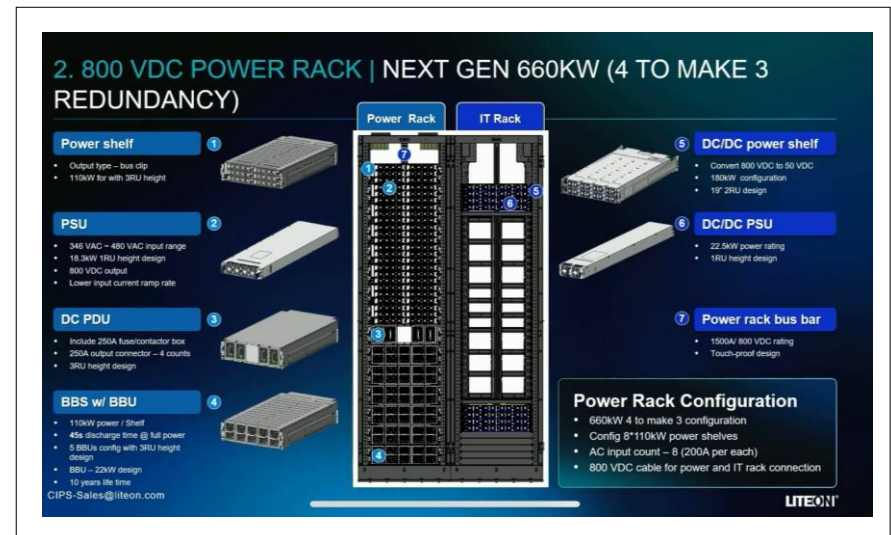
- 800V 아키텍처에서는 전력 공급 기능이 IT 랙 내부 PSU에만 머물지 않고, Power Shelf·DC/DC Shelf·Bus Bar·BBU 등으로 분화되며 별도 파워랙 영역을 형성
- AI GPU 부하는 초 미만 단위로 급변하기 때문에, 중앙 UPS만으로 모든 부하 대응 시 비용·수명 불리
- 따라서 계층형 전력 안정화 구조로 분화. 파워랙과 IT 랙을 분리하고, BBU·DC/DC 전환·버스바 등을 통합한 차세대 전력 아키텍처 등장
- 즉, 과거 중앙 UPS가 담당하던 전력 안정화 역할이 UPS/BESS → 파워랙 BBU → 보드/모듈 단으로 세분화되며, AI 랙 전용 신규 부품군이 형성되고 있음

데이터센터 전원 공급 구조 진화: 외부형 PSU 채택 시작



Source: Yole, 다올투자증권

800VDC Power Rack 구성 사례



Source: LITEON, 다올투자증권

III. 전기전자 2. 전력: 800V HVDC 랙의 본격 등장

Computex 2026에서 800V 생태계가 제품군으로 구체화

- Computex 2026에서는 800VDC AI 랙을 전제로 BBU, Ultracapacitor, Power Capacitance Shelf, DC/DC Shelf, Bus Bar 등이 독립 제품군으로 전면화
- 특히 Power Capacitance Shelf와 슈퍼캡 기반 모듈은 기존 중앙 UPS가 커버하기 어려운 1초 미만 ~ 초 단위 전력 변동을 랙 인접 영역에서 흡수하는 신규 레이어
- 결론적으로 800V 생태계는 단일 PSU 교체가 아니라, 전력 안정화 기능이 데이터센터 단위 → 파워랙 단위 → 보드/모듈 단위로 계층화되는 구조 변화

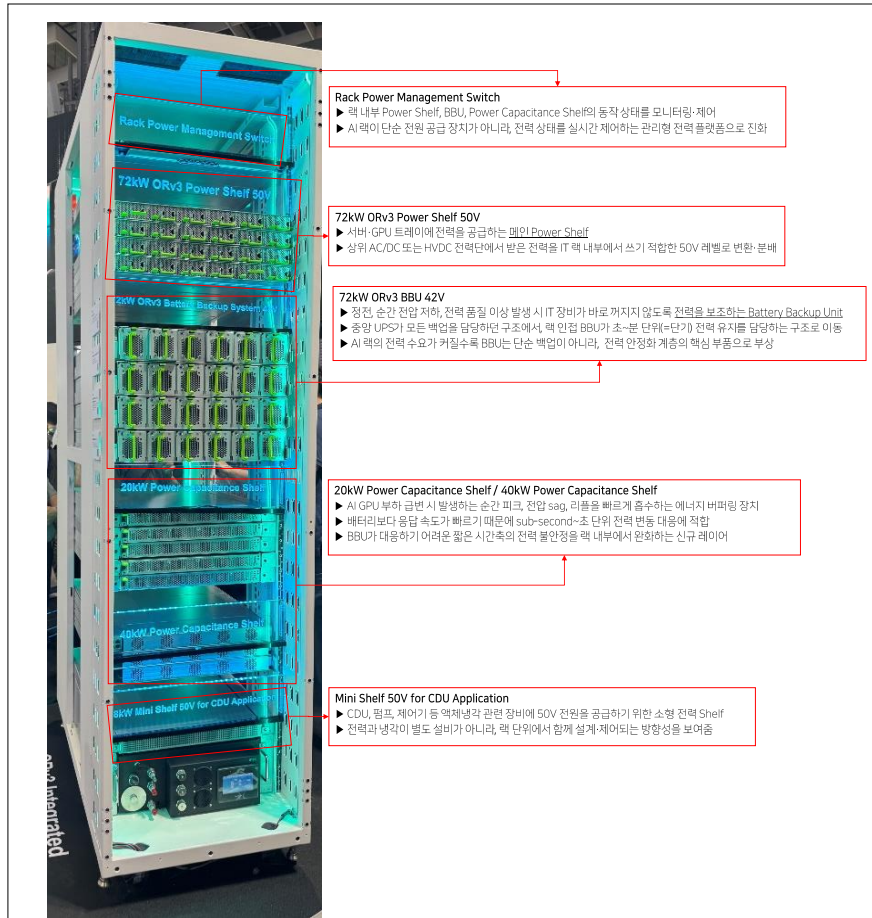
800V 파워랙 구성요소와 역할

제품군	주요 역할	대응 시간축	Computex 관찰 포인트
Power Rack	IT 랙과 분리된 전력변환·분배 플랫폼	상시 전력 공급	LITEON 등 800VDC 파워랙 공개
BBU (Battery Back Unit)	랙 단위 단기 백업 / 순간 정전 대응	초~분 단위	800V HVDC 랙과 결합되는 백업 모듈
Power Capacitance Shelf	순간 피크 흡수 / 전압 변동 완화	초 단위 미만 ~ 초 단위	기존에 없던 신규 제품군으로 구체화
DC/DC Shelf	800V DC를 IT 장비용 전압(48/54V)으로 변환	상시 변환	800V → 50V/48V 등 하위 전압 변환 모듈 공개
Bus Bar / Connector	고전류·고전압 전력 분배	상시 분배	케이블 축소, 고밀도 랙 배선 최적화

Source: 다올투자증권

III. 전기전자 2. 전력: 800V HVDC 랙의 본격 등장

LITEON ORv3 AI 랙



Source: LITEON, 다올투자증권

800V 파워랙 제품화 확산: Voltronic·MEGMEET 사례



Source: Voltronic Power, MEGMEET, 다올투자증권

III. 전기전자 2. 전력: 800V HVDC 랙의 본격 등장

밸류체인 시사점: 해외는 랙 시스템, 국내는 고전압 수동부품 중심 수혜

- 해외 밸류체인은 Delta, LITEON, Schneider, Vertiv 등 전력랙·PSU·BBU·CDU를 통합 공급하는 시스템 업체 중심으로 형성
 - 국내는 대형 시스템 OEM/ODM보다 MLCC·콘덴서·슈퍼커패시터·인덕터 등 고전압 수동부품 업체 중심의 간접 수혜 전망
- 향후 관건은 AI 서버향 고전압 MLCC·슈퍼커패시터·전력 부품 매출의 공급 및 양산 여부

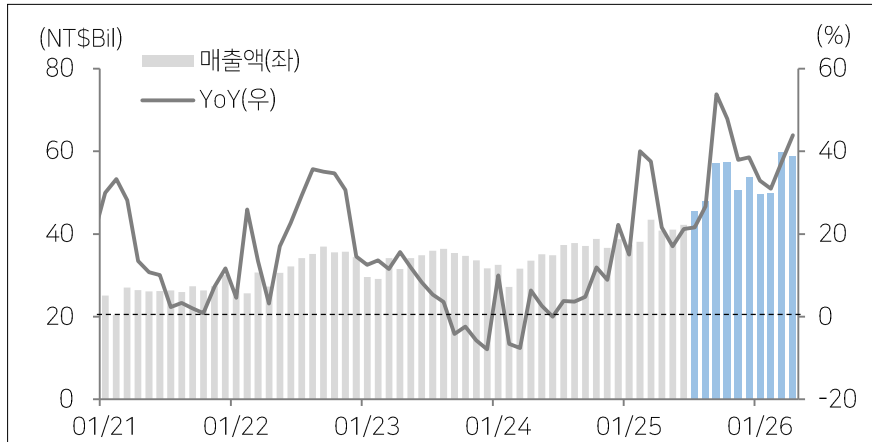
전력 관련 주요 밸류체인 및 투자 포인트

구분	기업	밸류체인 포지션	투자 포인트
해외	Delta	Power Rack / PSU / BBU / 전력변환 모듈	글로벌 데이터센터 전원장치 Top-tier. 800V 전환시 AC/DC, DC/DC, Power Shelf, BBU 등 랙 단위 전력 플랫폼 통합 공급 가능
	LITEON	800VDC Power Rack / DC PSU / DC/DC Shelf / BBU	Computex에서 800VDC Power Rack 구성 제시. IT Rack과 Power Rack 분리, 전력변환·분배·백업 기능의 랙 단위 통합 방향성 확인
	Vertiv	데이터센터 전력·냉각 인프라 / UPS / 전력관리	AI DC 전력·냉각 인프라 통합 업체. 800V 전환 이후에도 UPS, 전력관리, 냉각 인프라 연계 측면에서 중요
	Schneider Electric	데이터센터 전력배전 / 전력관리 / 인프라 솔루션	데이터센터 전력 배전 및 전력관리 시스템 업체. 800V HVDC가 확산될수록 고전압 배전, 보호장치, 전력관리 솔루션의 중요도 상승
	Eaton	UPS / 슈퍼커패시터 / 전력보호	중앙 UPS뿐 아니라 슈퍼커패시터 기반 순간 피크 대응 솔루션 보유. AI 랙의 전력 안정화가 계층화될수록 역할 확대 가능
국내	삼성전기	AI 서버용 MLCC / 실리콘캐패시터	AI 서버용 MLCC / 실리콘캐패시터 선두 업체. AI 랙 전력밀도 상승과 파워랙 확산에 따른 서버 내 고용량·고전압 MLCC 수요 확대
	아모텍	MLCC	26년 광네트워크용 MLCC가 핵심 화두. DSP·AOC용 공급 시작. 26년 글로벌 주요 팹리스 업체향 본격 매출 확대 구간
	삼화콘덴서	MLCC / 필름콘덴서 / 전력용 콘덴서	AI 데이터센터용 UPS·PDU·서버랙 PSU향 고전압 전력기기용 MLCC 수혜 기대
	비나텍	슈퍼커패시터	AI 데이터센터용 연료전지 비상전원에 슈퍼커패시터 공급. 향후 BBU 내 커패시터 공급 확대 기대
	코칩	소형 슈퍼커패시터 / 칩셀카본	AI 데이터센터향 슈퍼커패시터 수주 기대

Source: 다올투자증권

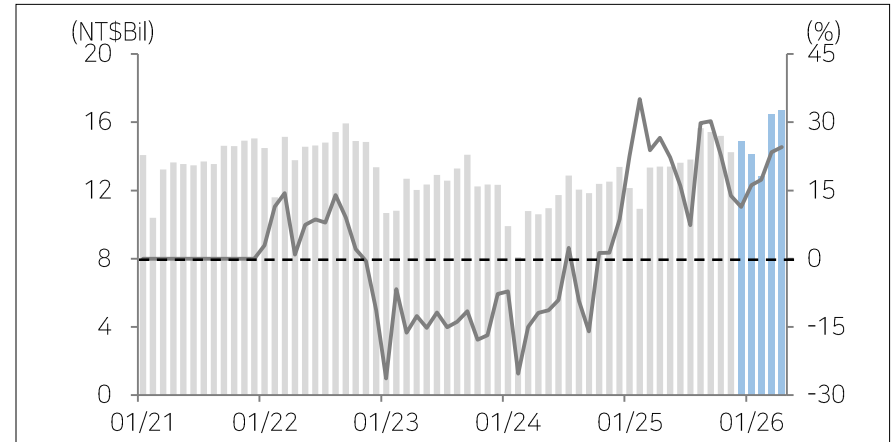
III. 전기전자 2. 전력: 800V HVDC 랙의 본격 등장

Delta 월별 매출액 추이



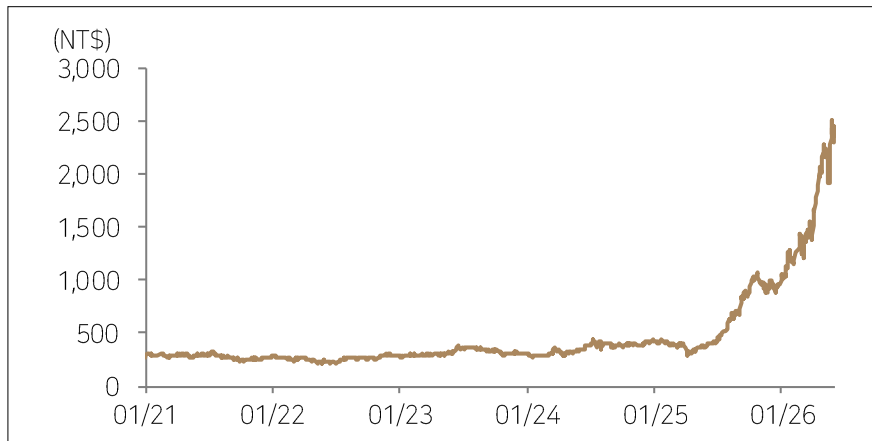
Source: Delta, 다올투자증권

LITEON 월별 매출액 추이



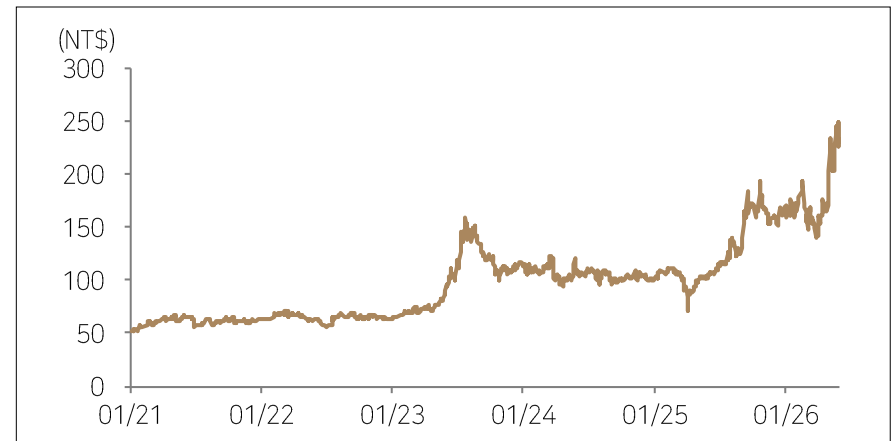
Source: LITEON, 다올투자증권

Delta 주가추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권

LITEON 주가추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권

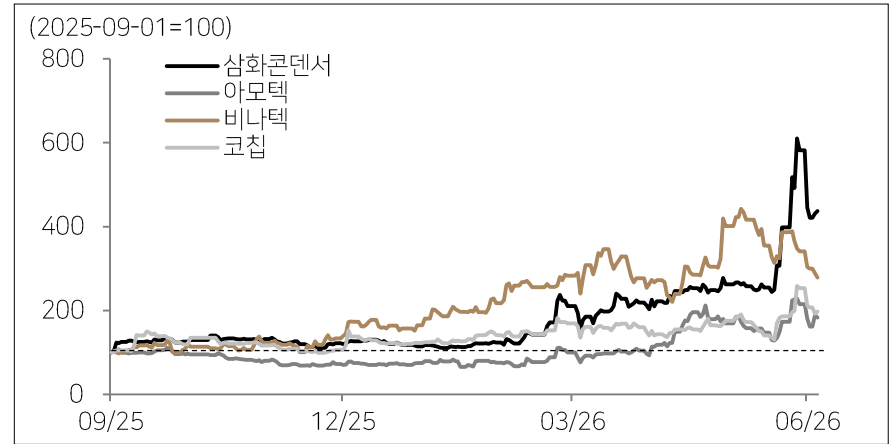
III. 전기전자 2. 전력: 800V HVDC 랙의 본격 등장

삼성전기 주가 추이



Source: QuantiWise, 다올투자증권

국내 수동부품 밸류체인 주가 추이



Source: QuantiWise, 다올투자증권

국내 수동부품 밸류체인 실적 종합

구분 종목	실적 및 Valuation (십억원, 원, 배)		실적						
			매출액	영업이익	OPM(%)	순이익	EPS	PER	
삼성전기 009150	증가(원) 시가총액(십억원)	1,757,000	2024	10,294	735	7.1	703	9,092	14.2
		131,237	2025	11,314	913	8.1	731	9,453	27.0
			2026E	13,520	1,636	12.1	1,347	17,675	99.8
아모텍 052710	증가(원) 시가총액(십억원)	24,100	2024	229	-24	-10.4	-20	-1,354	-
		352	2025	254	6	2.2	8	542	18.1
			2026E	264	10	11.8	8	534	45.2
삼화콘덴서 001820	증가(원) 시가총액(십억원)	111,800	2024	295	18	6.0	22	2,120	13.2
		1,162	2025	294	13	4.4	13	1,213	24.3
			2026E	-	-	-	-	-	-
비나텍 126340	증가(원) 시가총액(십억원)	121,600	2024	60	-8	-13.5	-10	-1,589	-
		869	2025	82	2	2.2	2	-1,091	-
			2026E	167	15	8.9	10	1,374	93.7
코칩 126730	증가(원) 시가총액(십억원)	23,500	2024	33	3	8.7	3	404	24.6
		206	2025	38	1	3.0	-1	335	43.7
			2026E	-	-	-	-	-	-

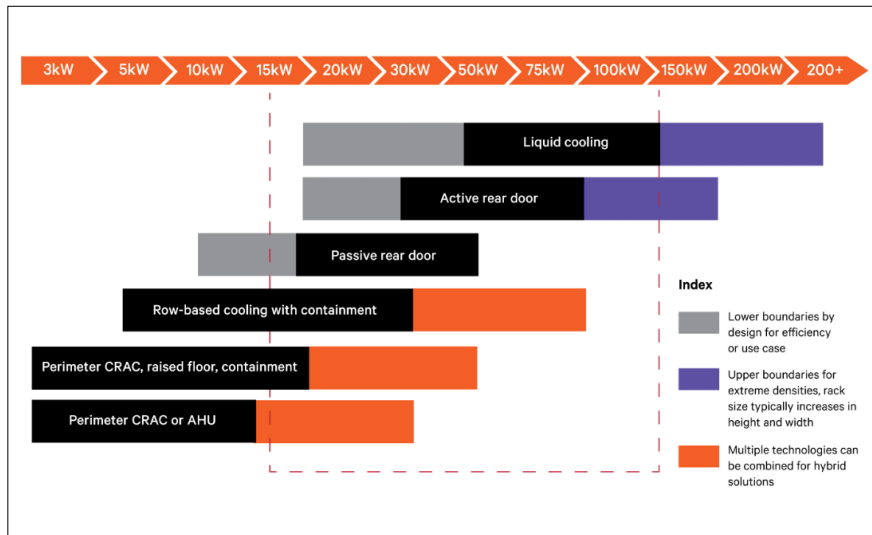
Source: QuantiWise, 다올투자증권 추정 / Note: 삼성전기는 다올투자증권 추정, 나머지는 컨센서스 기준

III. 전기전자 3. 냉각: D2C 액체냉각 표준화 & 액침냉각 확장 가능성

전력 다음 병목은 열: AI 랙의 냉각 구조 전환

- AI 랙 전력이 수백 kW에서 MW급으로 상승하면서, 냉각은 더 이상 데이터센터 설비의 보조 영역이 아니라 AI 서버 성능을 결정하는 핵심 인프라로 부상
- 기존 공랭 중심 구조는 랙 내부의 열을 공기로 빼내는 방식이기 때문에, GPU·CPU·HBM이 밀집된 고전력 AI 랙에서는 열 제거 효율과 공간 효율 측면에서 한계
- AI 인프라 경쟁은 칩을 얼마나 많이 넣느냐에서 넣은 칩이 과열로 인한 성능 저하 없이 안정적으로 동작하도록 전력과 열을 어떻게 관리하느냐로 이동

고밀도 AI 랙에서는 액체냉각이 표준 스탠다드



Source: Vertiv, 다올투자증권

냉각 방식별 특징

구분	공랭	액체냉각 (D2C)	액침냉각
열 제거 방식	팬/공기 흐름으로 랙 내부 열 배출	칩 위 Cold Plate로 직접 열 제거	서버/보드를 냉각액에 침지
적용 영역	저~중밀도 랙	고밀도 AI 랙 주류	특수 고밀도/전력단 등
장점	기존 인프라 활용, 비용 낮음	기존 서버 구조 유지, 서비스성 우수	열 제거 성능 높음
한계	100kW+ 랙 대응 어려움	CDU·매니폴드·QD 필요	정비성·표준화·유체 관리 부담
결론	보조/하이브리드	당분간 주류	선택적 확장

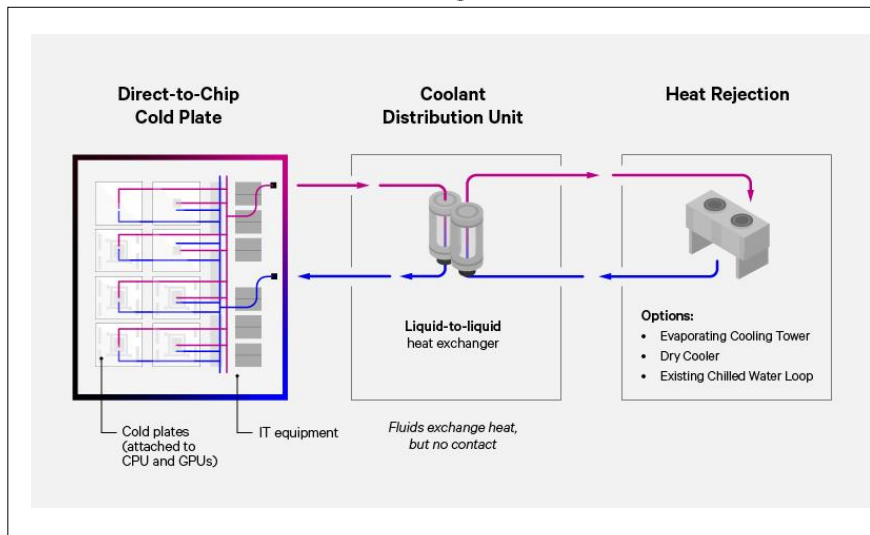
Source: 다올투자증권

III. 전기전자 3. 냉각: D2C 액체냉각 표준화 & 액침냉각 확장 가능성

냉각 패러다임: D2C 액체냉각이 당분간 주류

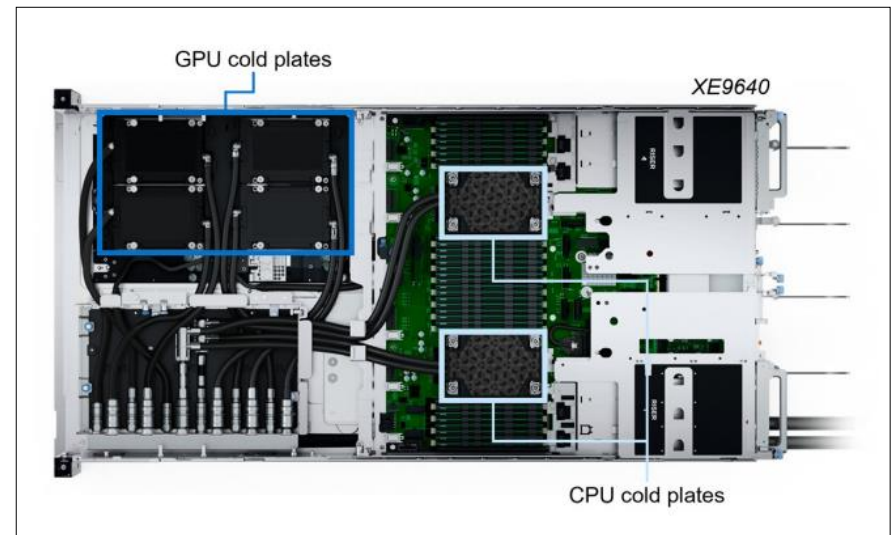
- Rubin / Rubin Ultra 세대까지 D2C(Direct-to-Chip) 액체냉각이 주류 해법. D2C는 칩 표면에서 직접 열을 제거할 수 있어 공랭 대비 고밀도 랙 대응력 높음
- 특히 GPU 트레이를 자주 교체·정비해야 하는 AI 서버 환경에서는 D2C 액체냉각이 액침냉각(Immersion cooling)보다 서비스성, 표준화, 공급망 성숙도 측면에서 유리
- 공랭 + D2C 하이브리드 구조를 통해 비용 효율적 냉각을 구성하는 것이 관건

D2C 액체냉각 구조



Source: Vertiv, 다올투자증권

컴퓨터 트레이 내부 콜드플레이트



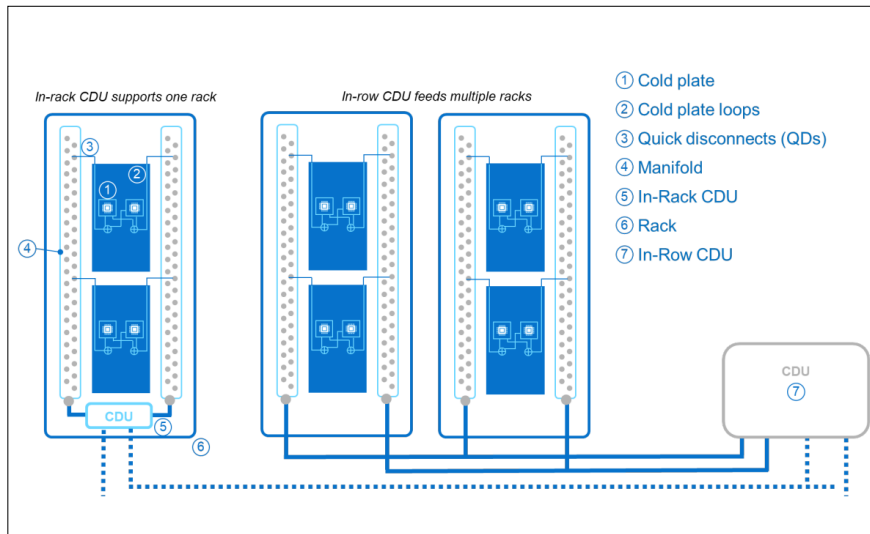
Source: DELL, 다올투자증권

III. 전기전자 3. 냉각: D2C 액체냉각 표준화 & 액침냉각 확장 가능성

냉각 밸류체인은 CDU·매니폴드·QD·콜드플레이트 등으로 세분화

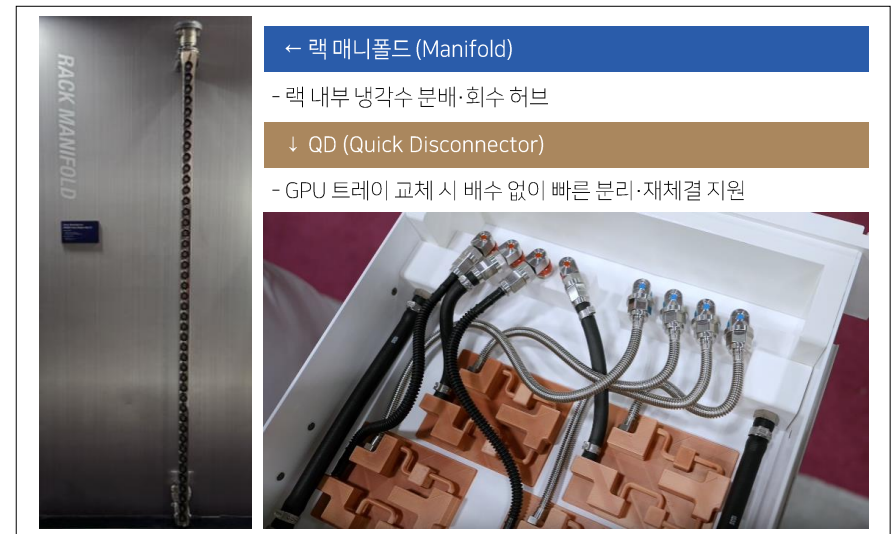
- 액체냉각 도입은 CDU, 매니폴드, QD(퀵디스커넥트), 콜드플레이트, 펌프, 밸브, 센서가 결합된 새로운 열 관리 시스템을 의미
- CDU는 데이터센터 시설수와 IT 장비 사이에서 열교환·유량·압력·온도를 관리하는 핵심 장비이며, 랙 고밀도화가 진행될수록 CDU 용량과 제어 성능이 중요
- 매니폴드와 QD는 랙의 냉각수 분배와 빠른 탈착을 담당하기 때문에, 블라인드메이트 랙 구조와 결합해 시 서버의 조립성·정비성·가동률을 좌우하는 부품군으로 부상
- Computex2026에서는 냉각 생태계가 장비·부품·검증 영역으로 세분화

D2C 냉각 루프와 CDU 배치 구조



Source: Vertiv, 다올투자증권

랙 내부 냉각수 연결부: Manifold와 Quick Disconnect



Source: NVIDIA, Stäubli, 다올투자증권

III. 전기전자 3. 냉각: D2C 액체냉각 표준화 & 액침냉각 확장 가능성

냉각은 랙에서 패키지로 이동: 양면 콜드플레이트와 VPD

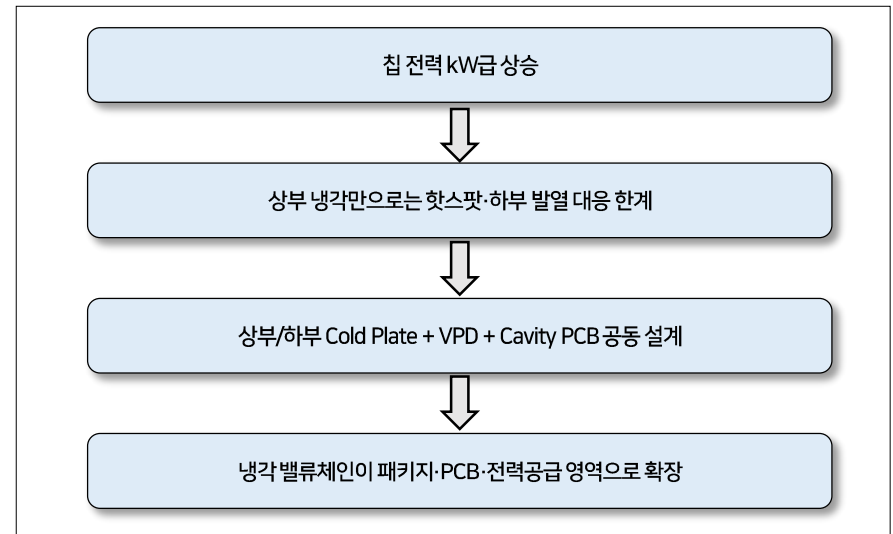
- Wiyynn은 6kW급 AI 칩을 대상으로 Top/Bottom Cold Plate를 적용한 양면 마이크로채널 냉각 솔루션을 공개
- 칩 위에 콜드플레이트를 붙이는 D2C를 넘어, Cavity PCB·Vertical Power Delivery·Liquid Metal TIM을 결합해 전력 공급 경로와 열 제거 경로를 동시에 최적화
- VPD는 칩 하부에서 수직으로 전력을 공급해 전력 분배 손실을 80% 이상 줄이는 것을 목표로 하며, 하부 발열까지 고려해 Bottom Cold Plate가 함께 적용
- 이는 AI 칩 고전력화에 따라 냉각 밸류체인이 서버 샤프에서 패키지·PCB·전력공급·열관리 공동 설계 영역으로 확장되고 있음을 시사

Wiyynn 6kW 대응 콜드플레이트 개념도



Source: Wiyynn, 다올투자증권

AI 칩 고전력화가 만드는 냉각 부품 설계 변화



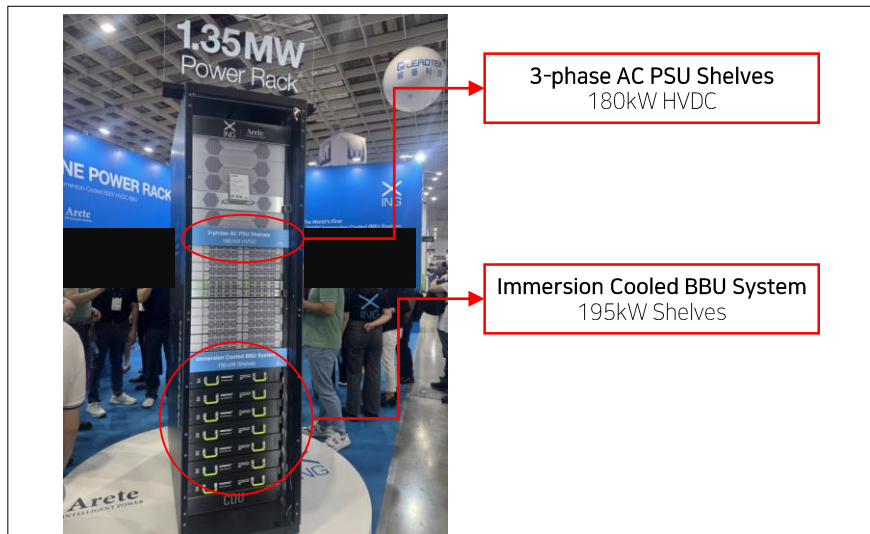
Source: 다올투자증권

III. 전기전자 3. 냉각: D2C 액체냉각 표준화 & 액침냉각의 확장 가능성

액침은 전력단에서 먼저 기회: XING/Arete 1.35MW HVDC 파워랙 등장

- Computex 2026에서 액침냉각 노출이 제한적이었다는 점은, GPU 컴퓨트랙에서 액침이 아직 표준 해법으로 자리잡지 못했음을 시사
- 서버 전체 침지(Immersion) 방식은 냉각 성능은 높지만, GPU 트레이 교체·정비·유체 관리·표준화 측면에서 대규모 AI DC 적용 부담이 존재
- 고무적인 점은, 액침냉각이 전력단인 BBU에서 새롭게 등장했다는 점. XING과 Arete가 세계 최초 액침냉각 BBU를 탑재한 HVDC 파워랙 공개
- 셀·DC 컨버터까지 유전체 냉각액에 직접 침지하는 구조는 표준 액체냉각만으로 대응하기 어려운 고출력 전력 백업 영역에서 액침냉각의 초기 적용 가능성을 시사

XING/Arete 1.35MW 액침 BBU 파워랙



Source: XING, 다올투자증권

액침 BBU의 역할: 피크 저감과 단기 전력 유지



Source: XING, 다올투자증권

III. 전기전자 3. 냉각: D2C 액체냉각 표준화 & 액침냉각의 확장 가능성

밸류체인 시사점: 미국·대만 업체 중심으로 공급망 형성, 국내 업체는 후발 진입

- AI 데이터센터 냉각 밸류체인은 CDU·콜드플레이트·QD·매니폴드·냉각수·센서/제어·시설 냉동기로 세분화되며, 단순 장비 공급보다 랙 단위 통합 설계 역량이 중요
- 해외는 Vertiv, Schneider, CoolIT, Boyd, Delta 등 CDU·콜드플레이트·냉각수 루프·제어 시스템을 통합 제공하는 시스템/모듈 업체 중심으로 시장 형성
- 국내는 LG전자가 CDU·콜드플레이트·칠러까지 확장하며 가장 종합적인 포지션을 구축 중

냉각 관련 주요 밸류체인 및 투자 포인트

구분	기업	밸류체인 포지션	투자 포인트	
해외	통합 시스템	Vertiv	CDU / 열관리 시스템 / 데이터센터 냉각 통합	CoolChip CDU·row manifold로 AI 랙 냉각 플랫폼 강화
	통합 시스템	Schneider Electric	CDU / 칠러 / 전력·냉각 인프라 통합	Motivair 기반 MW급 CDU 확대, AI DC 턴키 역량 부각
	통합 시스템	Delta	CDU / 칠러 / 전력·냉각 인프라 통합	전원장치 기반에서 콜드플레이트·CDU로 확장
	부품	Auras	콜드플레이트/CDU 등	대만 대표 AI 서버 냉각 업체. 2MW In-row CDU 공개, CPU·DIMM 냉각까지 확장
	부품	AVC	콜드플레이트 / 매니폴드 등	대만 대표 AI 서버 냉각 업체. AI 서버가 공랭에서 액체냉각으로 전환되면서 성장 가시성 ↑
	부품	CoolIT Systems	콜드플레이트 / 매니폴드	NVIDIA·AMD향 핵심 공급사, Ecolab 인수로 가치 재평가
	부품	Cooler Master	콜드플레이트 등	NVIDIA GB200/GB300 서버 액체냉각 핵심 공급사
	부품	Boyd	콜드플레이트 / 튜브 / QD	콜드플레이트+튜브+QD 통합 공급. D2C 표준화 시 콜드플레이트 어셈블리 공급망 핵심
국내	통합 시스템	LG전자	CDU / 열관리 시스템 / 데이터센터 냉각 통합	국내 상장사 중 가장 종합적인 냉각 포지션. 기존 HVAC 솔루션에 이어 데이터센터용 CDU·콜드플레이트 내재화
	장비	GST	액체냉각/액침냉각 장비	80~240kW급 L2L 액체냉각 장비 제시. CDU/액침냉각 장비 수혜 후보
	부품	해성디에스	히트슬러그 / 히트스프레더	리드프레임 기술 기반으로 AI 서버향 히트슬러그 진입 준비

Source: 다올투자증권

▶ Compliance Notice

당사는 본 자료를 기관투자가 등 제 3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 인수·합병의 주선 업무를 수행하고 있지 않습니다.
 당사는 자료작성일 현재 본 자료에서 추천한 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 계열사가 아닙니다.
 당사는 동 종목에 대해 자료작성일 기준 유가증권 발행(DR, CB, IPO, 시장조성 등)과 관련하여 지난 12개월간 주
 간사로 참여하지 않았습니다.
 당사는 상기 명시한 사항 외에 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.
 본 자료를 작성한 애널리스트 및 그 배우자는 발간일 현재 해당 기업의 주식 및 주식 관련 파생상품 등을 보유하고
 있지 않습니다.
 본 자료의 조사분석담당자는 어떠한 외부 압력이나 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성하였습니다.

▶ 투자등급 비율

BUY : 91.7% HOLD : 8.3% SELL : 0.0%

▶ 투자등급 관련사항

아래 종목투자의견은 향후 12개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함.
 · BUY: 추천기준일 종가대비 +15%이상
 · SELL: 추천기준일 종가대비 -15%미만.
 · HOLD: 추천기준일 종가대비 -15%이상 ~ +15%미만.

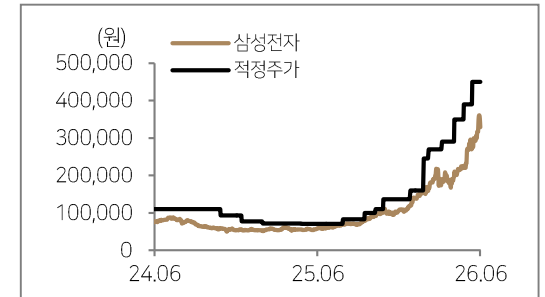
투자 의견이 시장 상황에 따라 투자등급 기준과 일시적으로 다를 수 있음.
 동 조사분석자료에서 제시된 업종 투자의견은 시장 대비 업종의 초과수익률 수준에 근거한 것으로, 개별 종목에 대한
 투자의견과 다를 수 있음.
 · Overweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 상회할 것으로 예상하는 경우
 · Neutral: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률과 유사할 것으로 예상하는 경우
 · Underweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 하회할 것으로 예상되는 경우
 주) 업종 수익률은 위험을 감안한 수치

▶ 최근 2년간 투자의견 및 적정주가 변경내용

삼성전자 (005930)

일자	2025.09.22	2025.10.14	2025.10.31	2026.01.02	2026.01.30	2026.02.10	2026.03.11	2026.04.08	2026.05.04	2026.05.19
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
주가	100,000원	110,000원	136,000원	160,000원	245,000원	270,000원	290,000원	350,000원	390,000원	450,000원
일자	적정주기(원)		평균 주기(원)		최고가(원)		평균주가 괴리율		최고가 괴리율	
2025.09.22	100,000		86,709		94,400		-13.3		-5.6	
2025.10.15	110,000		98,373		104,100		-10.1		-5.4	
2025.10.31	136,000		104,874		119,900		-22.9		-11.8	
2026.01.02	160,000		145,845		162,400		-8.9		1.5	
2026.01.30	245,000		161,686		169,100		-34.0		-31.0	
2026.02.10	270,000		189,000		218,000		-30.0		-19.3	
2026.03.11	290,000		188,225		208,500		-35.1		-28.1	
2026.04.08	350,000		215,324		226,000		-38.5		-35.4	
2026.05.04	390,000		272,611		296,000		-30.1		-24.1	
2026.05.19	450,000		-		-		-		-	

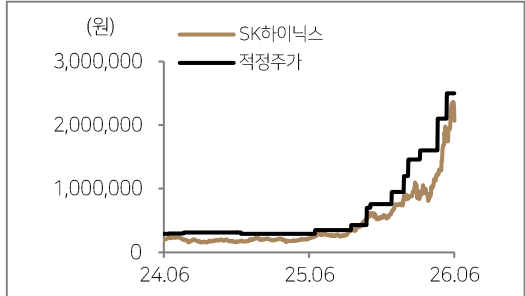
* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 증가 산출일(2026년 6월 5일) ** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가



SK하이닉스 (000660)

일자	2025.06.23	2025.09.22	2025.10.30	2025.11.06	2026.01.02	2026.01.30	2026.02.10	2026.03.11	2026.04.24	2026.05.19
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
주가	350,000원	430,000원	700,000원	760,000원	950,000원	1,200,000원	1,460,000원	1,600,000원	2,100,000원	2,500,000원
일자	적정주가(원)		평균 주가(원)		최고가(원)		평균주가 괴리율		최고가 괴리율	
2025.06.23	350,000원		279,070원		353,000원		-20.3		0.9	
2025.09.22	430,000원		428,609원		558,000원		-0.3		29.8	
2025.10.30	700,000원		582,400원		620,000원		-16.8		-11.4	
2025.11.06	760,000원		569,211원		651,000원		-25.1		-14.3	
2026.01.02	950,000원		754,100원		861,000원		-20.6		-9.4	
2026.01.30	1,200,000원		873,429원		909,000원		-27.2		-24.3	
2026.02.10	1,460,000원		935,765원		1,099,000원		-35.9		-24.7	
2026.03.11	1,600,000원		1,003,844원		1,225,000원		-37.3		-23.4	
2026.04.24	2,100,000원		1,590,071원		1,976,000원		-24.3		-5.9	
2026.05.18	2,500,000원		-		-		-		-	

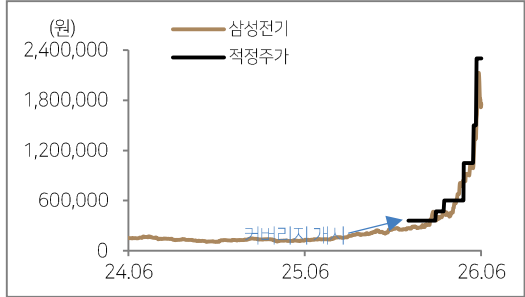
* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 증가 산출일(2026년 6월 5일) ** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가



삼성전기 (009150)

일자		2026.01.06	2026.03.05	2026.03.20	2026.05.04	2026.05.21	2026.05.28			
투자의견	커버리지	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY			
주가	개시	360,000원	470,000원	600,000원	1,050,000원	1,500,000원	2,300,000원			
일자	적정주가(원)		평균 주가(원)		최고가(원)		평균주가 괴리율		최고가 괴리율	
2026.01.06	360,000원		318,132원		466,500원		-11.63		29.58	
2026.03.05	470,000원		418,091원		479,500원		-11.04		2.02	
2026.03.20	600,000원		584,817원		839,000원		-2.53		39.83	
2026.05.04	1,050,000원		963,636원		1,031,000원		-8.23		-1.81	
2026.05.21	1,500,000원		1,372,000원		1,572,000원		-8.53		4.8	
2026.05.28	2,300,000원		-		-		-		-	

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 증가 산출일(2026년 6월 5일) ** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가



Research Division

DAOL 다올투자증권

리서치본부장 김현
hyunkim@daolfn.com

기업분석

조선 · 기계 · 방산
최광식
gs.choie@daolfn.com

건설 · 부동산
박영도
ypark@daolfn.com

자동차 · 이차전지
유지웅
jwyoo@daolfn.com

제약 · 바이오
이지수
jislee@daolfn.com

금융
김지원
jiwonkim@daolfn.com

반도체 · 소부장
고영민
ym.ko@daolfn.com

화장품 · 의료기기
박종현
alex.park@daolfn.com

인터넷 · 게임 · 레저
김혜영
hyyy@daolfn.com

음식료
이다연
dayeonlee@daolfn.com

철강
이정우
jungwoo@daolfn.com

엔터테인먼트
임도영
dy.lim@daolfn.com

전기전자
김연미
ym.kim@daolfn.com

투자전략

투자전략
조병현
bhcho@daolfn.com

계량분석
김경훈
aimhigh2027@daolfn.com

채권분석
허정인
jeongin@daolfn.com

시황분석
김지현
jeehyun12@daolfn.com

최근 3개월간 발간한 In-Depth

2026.04.07	최광식	조선 - 해가 지지 않는 조선제국: 2번째 발걸음 HHIP
2026.04.23	임도영	엔터테인먼트 - 실적과 멀티플의 괴리 속에서
2026.05.06	유지웅 · 오정하	자동차&로봇 - 메가트렌드의 시작
2026.05.21	고영민	반도체/소부장 2H26 전망 - 꺼지지 않는 초록불
2026.05.25	최광식	방산 - 실전, 현지화, 그래서 K-방산: 파이프라인 가치 Valuation
2026.05.28	조병현 · 박영찬 · 정현하	2026년 하반기 매크로 전망: 달라지는 관계들
2026.05.28	김연미	전기전자 - AI는 기판 위에서 흐른다
2026.05.28	김혜영	인터넷·게임·레저 - 월드 모델을 타고 AGI로 가자
2026.05.29	박종현	의료기기 - Sex and the diagnostics
2026.06.02	이지수	제약 · 바이오 - Who's Ready?: K-BIO, 준비됐는가?
2026.06.05	조병현 · 김지현	2026년 하반기 주식시장 전망: Climb a little higher

www.daolfn.com

본사 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워

본사영업점 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워 27층

DAOL 다올투자증권

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위한 정보제공을 목적으로 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.